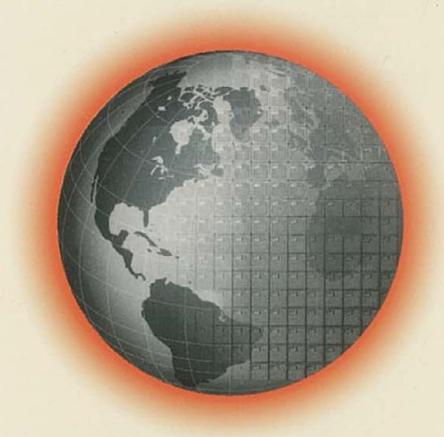


台灣積體電路
製造股份有限公司
八十六年度年報



辦事處名稱

公司本部及晶圓二廠、五廠

新竹科學工業園區區三路121 號

電話:886-3-578-0221 傳真:886-3-578-1546

晶圓一廠

新竹縣竹東鎮中興路四段195 號67 館

電話:886-3-582-1240 傳真:886-3-582-2616

晶圓三廠、四廠

新竹科學工業園區研新一路9 號

電話:886-3-578-1688 傳真:886-3-578-1548

美國子公司

1740 Technology Drive, Suite 660, San Jose,
CA 95110, U.S.A.

電話:1-408-437-8762 傳真:1-408-441-7713

歐洲子公司

World Trade Center, Strawinskylaan 1145,
1077 XX Amsterdam, The Netherlands

電話:31-20-305-9900 傳真:31-20-305-9911

日本子公司

16F, Queen's Tower C, 2-3-5

Minato Mirai, Nishi-Ku, Yokohama,

Kanagawa 220, Japan

電話:81-45-682-0670 傳真:81-45-682-0673

公司發言人

姓名：黃彥群

職稱：副總經理

電話:886-3-578-0221

傳真:886-3-578-1545

簽證會計師

事務所名稱：勤業會計師事務所

會計師姓名：黃樹傑、魏永篤

地址：台北市民生東路三段156 號12 樓

電話:886-2-2545-9988

傳真:886-2-2545-9966

辦理股票過戶機構

中國信託商業銀行代理部

台北市重慶南路一段83 號5 樓

電話:886-2-2361-3033

傳真:886-2-2311-6723

目錄

致股東營運報告書 3

公司概況 6

一、公司簡介

二、組織表

三、董事及監察人

四、主要經理人

五、公司債及特別股之發行情形

營運概況 12

一、業務內容

二、市場及行銷

三、市場分析

四、最近三年度從業員工人數

五、轉投資事業

六、環境保護措施

七、勞資關係

八、重要契約

九、前各次現金增資或募集公司債計畫尚未 完成者之執行情形

十、訴訟事件

營業計畫 22

一、八十七年度增資擴充計畫

二、八十七年度產銷計畫

三、研究發展計畫

財務資料 25

一、簡明資產負債表

二、簡明損益表

三、財務分析

四、每股淨值、盈餘、股利及市價

五、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

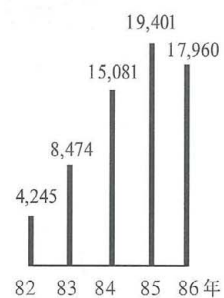
六、監察人審查報告書

七、財務報表暨會計師查核報告書

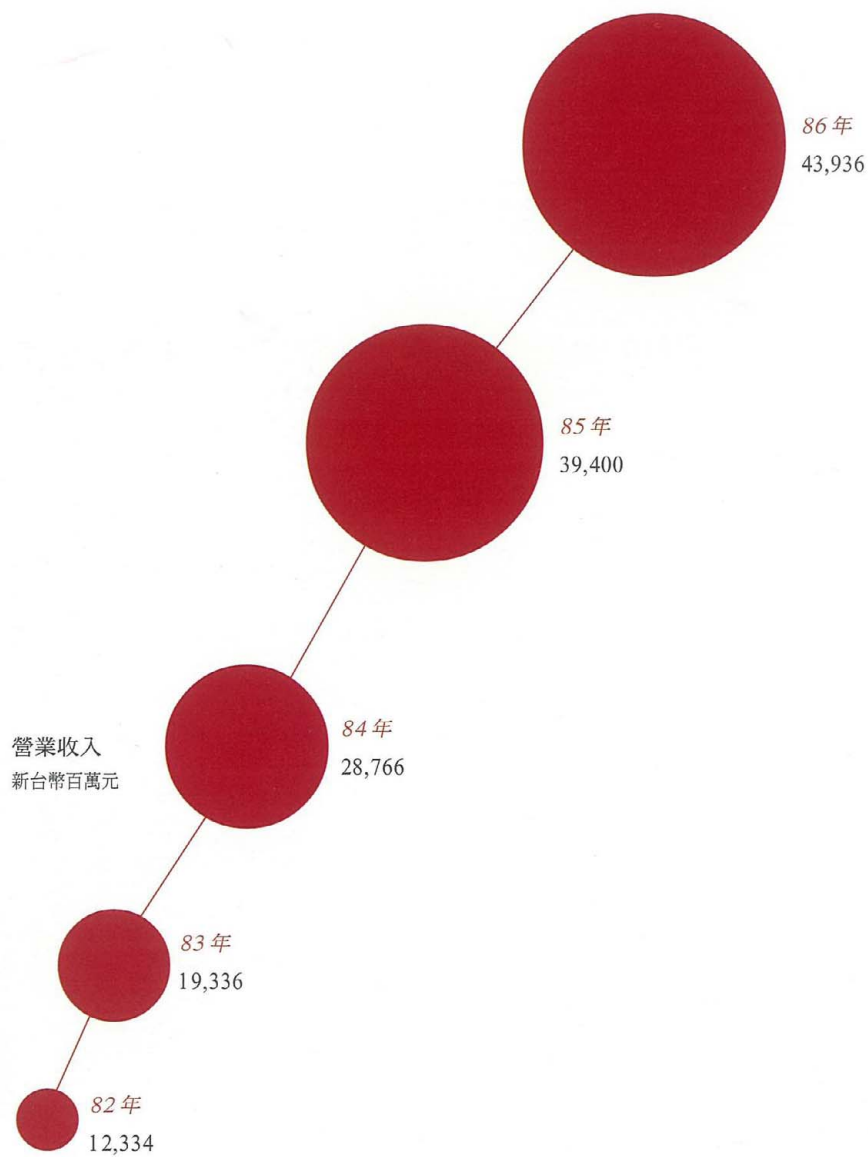
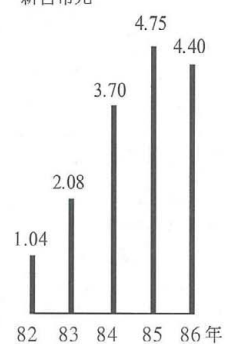
八、合併財務報表

九、財務狀況及經營結果之檢討分析

稅後純益
新台幣百萬元



每股盈餘
新台幣元



經營理念

- 堅持高度職業道德。
- 專注於「專業積體電路製造服務」本業。
- 放眼世界市場，國際化經營。
- 注意長期策略，追求永續經營。
- 客戶是我們的夥伴。
- 品質是我們工作與服務的原則。
- 鼓勵在各方面的創新，確保高度企業活力。
- 營造具挑戰性、有樂趣的工作環境。
- 建立開放型管理模式。
- 兼顧員工福利與股東權益，盡力回饋社會。

各位股東女士／先生：

民國八十六年對台積公司而言是十分精彩的一年……

「晶彩十年」，我們進行了許多新計畫，更締造了許多新紀錄，為台積過去的十年留下璀璨的註腳，也為下一個十年做了最好的準備。

本公司的營收及獲利在八十六年再度締造了優異的成績，分別達到新台幣439億及179億元，獲利率41%。同時，我們的兩座八吋晶圓廠一晶圓四廠及五廠也在八十六年內進入量產，為公司產能的提升注入新力量。而為了因應下一波晶圓專業製造服務需求，我們更規劃了未來十年在台南科學園區的投資計劃，將投入四千億元興建六座最先進的晶圓廠。此外，由於公司的傑出表現及優良企業形象，我們所發行的美國存託憑證(ADR)於八十六年十月順利在美國紐約證券交易所(NYSE)掛牌，成為我國第一家在此證券市場上市的公司。

產能提升

本公司積體電路製造的總產出量，從八十五年的84萬片八吋晶圓，到八十六年的119萬片八吋晶圓，年成長幅度高達40%以上。其中不但晶圓三廠及晶圓四廠的產能逐月穩定成長，晶圓五廠更較原訂時程提前於八十六年第四季起就加入生產行列。



董事長兼總經理 張忠謀



左至右：
魏哲家 副總經理
黃彥群 副總經理

此外，晶圓六廠業已於八十六年七月於台南科學園區開始動土興建，而位於美國華盛頓州的合資晶圓廠—WaferTech也加速興建中，預計將在民國八十七年中開始生產。

技術領先

在技術方面，民國八十六年本公司已大量地運用0.35微米製程為客戶之新產品進行量產；0.3微米製程也已在年底進入量產。而為緊密配合市場變遷、協助客戶推出新一世代的產品，0.25微米製程技術也已在民國八十六年中開發完成，提供給客戶設計最新產品，並在八十七年初進入量產。此外，有鑑於各種嵌入式記憶體製程為明日之星，我們已特別成立專案小組負責嵌入式快閃、動態及靜態隨機存取記憶體製程。

至於新一世代十二吋晶圓製造技術的研發上，本公司更為台灣業界的先驅，是國內唯一加入國際半導體組織所設之十二吋晶圓製程研發專案(SEMATECH-I300I)的公司。這些具體行動，在在展現出我們十年來一直以最快的速度，提供客戶最先進技術的堅持與決心。

市場開發

本公司的堅實客戶群遍佈全球！其中美洲地區一直是我們最主要的市場，營業額佔公司營收的42%；來自歐洲地區客戶的業務則佔公司整體營收的8%；國內市場亦十分蓬勃，約佔本公司營收的26%；而除國內、日本之外的其他亞洲地區佔了13%。至於日本市場在去年出現了快速的成長，達到11%；也因此我們特別於民國八十六年底在日本成立子公司，以全力拓展此地區之業務。

經營團隊

我們一直把眼光放在全世界！積體電路是一個跨國界的產業，我們已是一個十足國際化經營的公司，在全球晶圓專業製造服務領域上，建立了最強的競爭力與領導地位。

我們把眼光放在全世界！
因此我們不僅延攬了全球半導體界專業人士，更尋求各領域中的菁英份子，組成最堅強的經營團隊。



也因此，在人才的延攬方面，我們不但一直致力於全球半導體專業傑出人士的招募，更在其他經營管理等領域，不斷尋求有傑出專業表現且志同道合的菁英份子加入。在過去一年當中，我們陸續延攬了多位在不同專業領域中學有專精、經驗豐富的副總級高階主管，壯大了原本就已十分堅強的經營團隊，將共同帶領台積公司開創更美好的未來。

未來展望

民國八十五年我們提出了「虛擬晶圓廠」的願景，並隨即開始積極的行動。我們的策略是更進一步強化與客戶間的緊密關係，以構建長期競爭優勢。這些工作雖然已經大體完成，仍將是我們在新年度中繼續努力的方向。

展望民國八十七年，全球半導體產業可能有5%至10%左右的成長，其中晶圓專業製造服務市場的成長更將超越整體產業水準。雖然由於本公司過去十年的優異表現，吸引了眾多後繼者加入競逐，致使晶圓專業製造服務領域競爭日趨激烈。然而，我們相信在堅實的「虛擬晶圓廠」策略下，我們的產能將在新的年度裡成長40%，並不斷為客戶提供最好的服務，繼續保持我們在全球市場的領導地位，再創另一個全新而值得驕傲的「晶彩十年」。

最後，要誠摯地感謝努力不懈的員工，我們的客戶，以及各位股東女士、先生，對您們長久以來的不斷支持，謹致上最深的謝忱！

董事長兼總經理

張忠謀



左至右：

蔡力行 執行副總經理
楊平 副總經理
左大川 資深副總經理
陳健邦 副總經理
蔣尚義 副總經理

立者左至右：

林坤禧 資深副總經理
張孝威 資深副總經理
陳國慈 資深副總經理

中坐者：

Ron Norris 美國子公司總經理



一、公司簡介

台灣積體電路製造股份有限公司(簡稱台積電)，成立於民國七十六年，並於民國八十三年成為在台灣證券交易所掛牌之上市公司。本公司之美國存託憑證亦於民國八十六年在美国紐約證券交易所(NYSE)以 TSM 為代號開始掛牌交易。

本公司位於有台灣矽谷之稱的新竹科學工業園區，是全球第一家以最先進的製程技術提供晶圓專業製造服務(即一般所謂「晶圓代工」)的公司，不設計或生產自有品牌產品，而提供所有的產能為客戶服務。由於此項策略與堅持，使本公司自成立以來，不但成為全球積體電路業者最忠實的夥伴，更確立了全球積體電路產業的專業分工模式。目前全球晶圓專業製造服務已發展成為一個年營業額數十億美元的產業，而在半導體產業持續分工以及新晶圓廠投資日益龐大的趨勢下，專業的晶圓製造服務公司有非常大的機會成為全球半導體製造產能的主要供應來源。

截至民國八十六年底，本公司擁有六吋積體電路晶圓廠兩座(晶圓一、二廠)，八吋晶圓廠三座(晶圓三、四、五廠)，八十六年中共產出119萬片八吋晶圓(約當量)，是世界最大的晶圓專業製造服務公司。為因應第二波來自整合元件製造商對晶圓專業製造服務的需求，並確保本公司在市場的領導地位，我們將投資新台幣四千億元資金在台南科學園區興建六座最先進的晶圓廠。其中第一座「晶圓六廠」已於民國八十六年中動土興建。此外，在北美地區與客戶合資設立的WaferTech公司，其第一座八吋晶圓廠亦在興建中，預計於民國八十七年中開始量產。

除了產能優勢外，本公司亦不斷開發新一世代之量產製程技術，以確保製程技術的領先。在策略上，我們同時著重在技術的深度及廣度上。在深度方面，除了已大量運用0.35微米製程為客戶新產品進行量產，0.25微米製程亦開發完成，並於民國八十七年初進入量產。在廣度方面，則以客戶需求最殷的互補金氧半導體邏輯製程(CMOS Logic)為核心，同時提供類比/數位混合製程(mixed-signal)、單晶片或嵌入式(embedded)記憶體製程、雙載子互補金氧半導體製程(BiCMOS)技術以及設計支援服務，以充份滿足不同客戶的各種需求。我們堅信，唯有如此才能真正提供最大的附加價值給客戶，也才能成為客戶最佳的合作夥伴。

要在晶圓專業製造服務業中贏得長期的勝利，除了最佳的製程技術、品質及領先的產能優勢外，服務水準尤為關鍵所在。本公司提出成為客戶「虛擬晶圓廠」的願景，其目標就是提供客戶最好的服務，





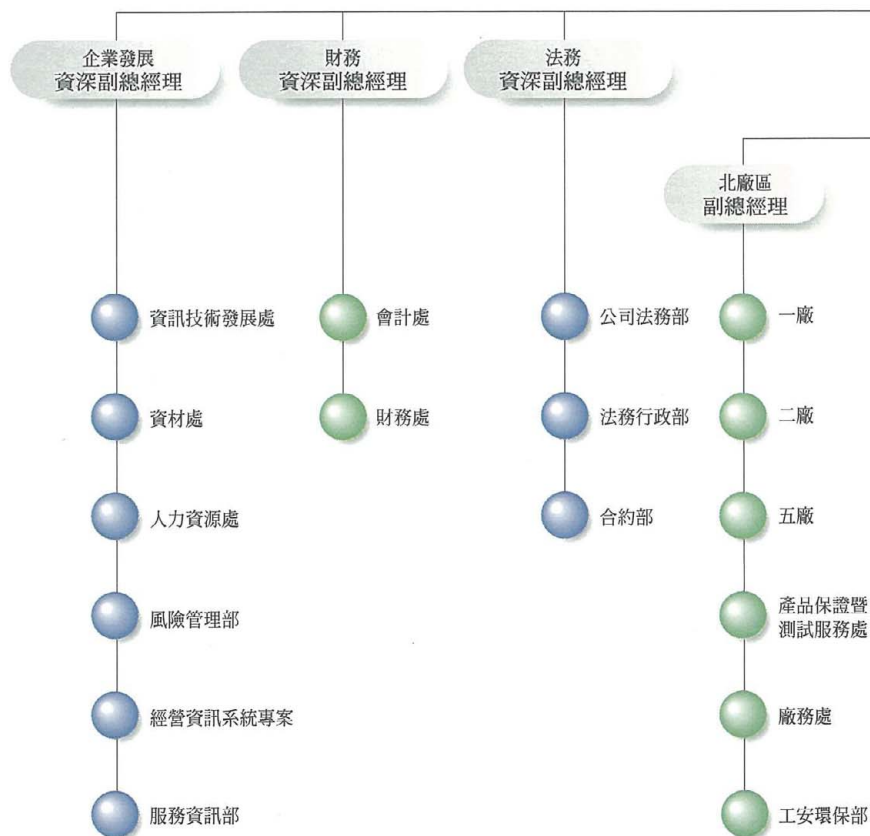
我們在建立服務全世界的虛擬晶圓廠！
以精良的技術、豐沛的產能、最佳的品質、卓越的服務，
做為客戶在晶圓專業製造上，最堅實的夥伴。

給予他們所有相當於擁有自己晶圓廠的便利與好處，同時免除客戶自行設廠所需的大筆資金投入及管理上的問題。在此策略領導下，本公司將能構建更大的競爭優勢，並鞏固在晶圓專業製造服務業中的領導地位。

本公司自成立以來，一直致力於技術及市場的領先，並以實際行動回饋員工、股東及社會大眾，歷年來屢獲政府單位頒發環境保護、污染防治、工業安全、人力培訓、員工福利、熱心公益等績優企業獎項，並被中外著名媒體評選為台灣最佳標竿企業。而董事長張忠謀博士不僅獲得美國商業週刊評選為 1997 年全球最佳專業經理人之一，更獲得美國 BancAmerica Robertson Stephens 遴選為半導體業五十年歷史最具貢獻者之一。



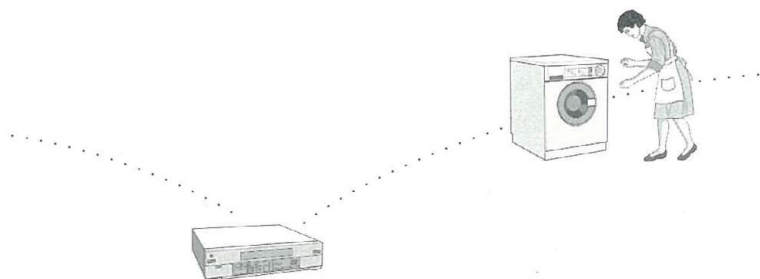
二、組織表

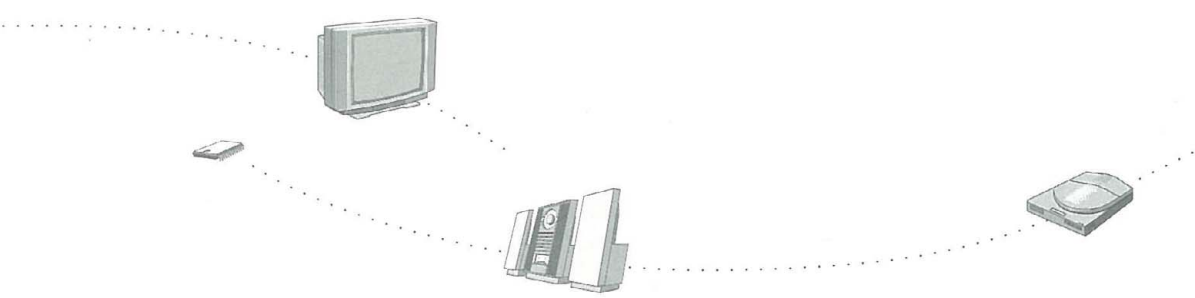
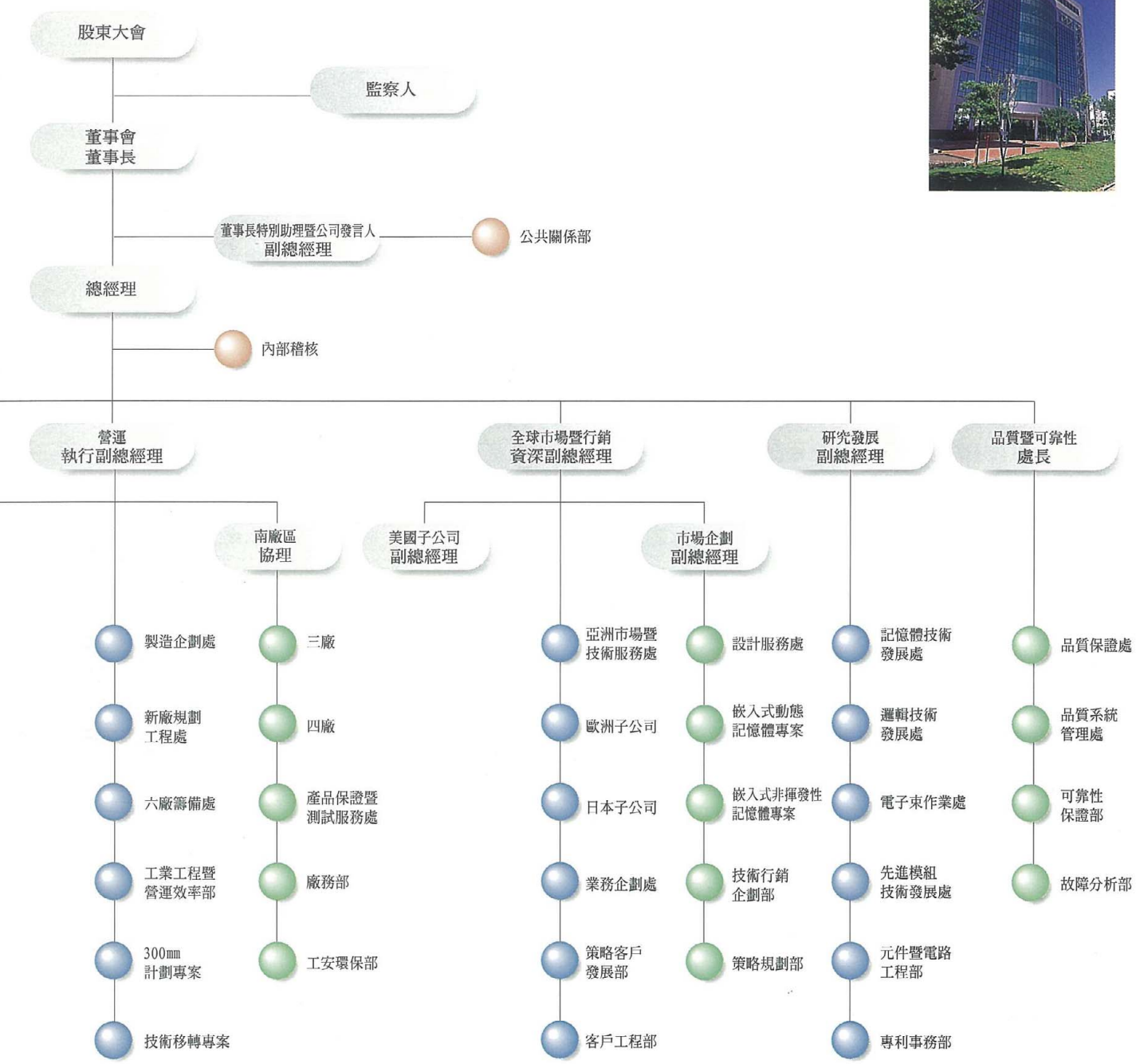


讓生活更鮮活

當您走入家中……

從CD、DVD、Hi-Fi音響，到高傳真電視的鮮活聲色享受；從冰箱、洗衣機、到冷暖氣機中的人工智慧，積體電路已深入每一個家庭，讓人們享受更舒適更便利的生活！





三、董事及監察人

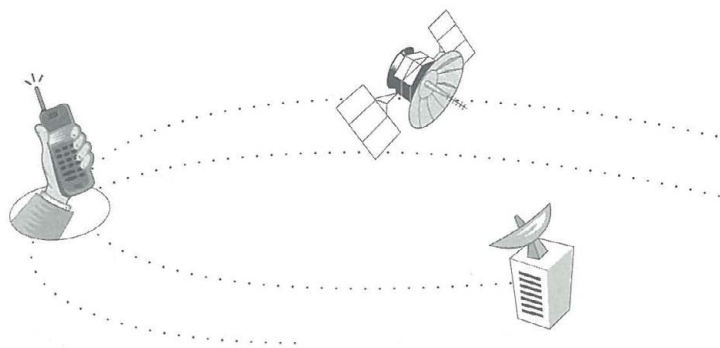
*本資料基準日為87年2月28日

職稱 姓名	選任 日期	任期 (年)	持有股份 (註)	配偶及未 成年子女 持有股份	主要學經歷	備註
董事長 張忠謀	86.5.13	3	29,584,349	無	美國史丹福大學電機工程博士/世界先進積體電路(股)公司董事長/台灣慧智(股)公司董事長/本公司董事長兼總經理	
董事 范德普	86.5.13	3	726,597,083	無	荷蘭 Eindhoven 技術大學電子工程系 / 飛利浦半導體國際(股)公司董事長暨執行長	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 羅貝茲	86.5.13	3	726,597,083	無	荷蘭 Erasmus 大學商業經濟系 / 飛利浦半導體國際(股)公司財務總長	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 柯慈雷	86.5.13	3	726,597,083	無	荷蘭 Eindhoven 技術大學電子工程系 / 飛利浦在台各企業組織總裁	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 許祿寶	86.5.13	3	726,597,083	無	國立成功大學物理系 / 飛利浦在台各企業組織執行副總裁	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
董事 林明德	86.5.13	3	763,219,720	無	美國麻省理工學院地球科學碩士 / 台灣神隆(股)公司副董事長	行政院開發基金管理委員會代表人
董事 顏慶章	86.5.13	3	763,219,720	無	美國密西根大學法學碩士 / 財政部政務次長	行政院開發基金管理委員會代表人
董事 史欽泰	86.5.13	3	763,219,720	無	美國普林斯頓大學電機博士 / 工業技術研究院院長	行政院開發基金管理委員會代表人
董事 吳亦圭	86.5.13	3	14,250,000	無	中國海專 / 順昶塑膠公司董事長	懋昌投資股份有限公司代表人
董事 曾繁城	86.5.13	3	5,597,455	246,639	國立成功大學電機工程博士 / 世界先進積體電路(股)公司總經理	
監察人 歐盛	86.5.13	3	726,597,083	無	荷蘭 Tilburg 大學經濟系 / 飛利浦在台各企業組織執行副總裁	荷蘭商飛利浦電子股份有限公司代表人
監察人 胡仲英	86.5.13	3	763,219,720	無	中央大學理學博士 / 行政院經建會部門計劃處處長	行政院開發基金管理委員會代表人
監察人 胡新南	86.5.13	3	6,063	無	美國密西根大學化工碩士 / 趙廷箴文教基金會董事長	

註：以上所列董監事持有股數為87年2月28日實際持有股數

讓溝通無遠弗屆

當大哥大出現時，您一定覺得這已經是跨世紀的發展；然而在積體電路的突破與進展下，不僅行動電話的品質日益精進，影音同步的視訊電話更讓通訊世界更多樣化。全球無時差的溝通與聯繫已正式進入你我的生活！



四、主要經理人

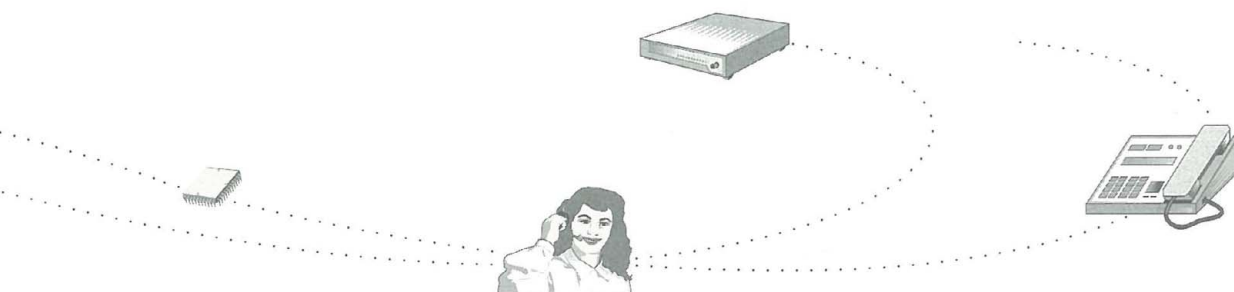
*本資料基準日為87年2月28日

職稱 姓名	就任 日期	持有股份 (註)	配偶及未成年 子女持有股份	主要學經歷
總經理 張忠謀	86.05.01	29,584,349	無	美國史丹福大學電機工程博士 / 世界先進積體電路(股)公司董事長 / 台灣慧智(股)公司董事長 / 本公司董事長兼總經理
執行副總經理 蔡力行	84.09.01	2,620,527	無	美國康乃爾大學材料科學博士 / 本公司南廠區副總經理 / 本公司營運執行副總經理
資深副總經理 林坤禧	84.09.01	3,119,728	805,489	美國肯塔基大學企管博士 / 本公司行銷副總經理 / 本公司企業發展資深副總經理
資深副總經理 左大川	86.03.04	710,000	無	美國加州大學柏克萊分校材料科學博士 / 美商應用材料公司先進技術部門總經理 / 本公司研發副總經理 / 本公司全球市場暨行銷資深副總經理
資深副總經理 陳國慈	86.11.24	1,000	無	英國及美國加州律師 / 財團法人國家文化藝術基金會執行長 / 本公司資深副總經理暨法務長
資深副總經理 張孝威	87.02.03	0	無	美國賓州大學華頓商學院企管碩士 / 中華開發公司總經理 / 中華證券投資信託公司董事長 / 本公司資深副總經理暨財務長
副總經理 黃彥群	84.09.01	2,788,888	136,797	美國塞基諾大學企管碩士 / 本公司行政副總經理 / 本公司董事長特別助理暨發言人
副總經理 陳健邦	86.05.13	575,377	無	國立清華大學物理碩士 / 本公司北廠區協理 / 本公司北廠區副總經理
副總經理 蔣尚義	86.08.05	400,000	無	美國史丹福大學電機工程博士 / 美國惠普科技公司實驗室元件研發及應用部門經理 / 本公司研究發展副總經理
副總經理 楊 平	86.11.18	0	無	美國伊利諾大學電機工程博士 / 美國德州儀器公司半導體製程及元件中心處長 / 本公司市場企劃副總經理

註：以上所列主要經理人持有股數為87年2月28日實際持有股數

五、公司債及特別股之發行情形

本公司為配合擴廠需要，於八十六年七月三日發行海外第一次有擔保可轉換公司債美金350,000仟元，票面年利率0%，本金及利息補償金於九十一年七月三日期滿時一次償還。轉換價格於發行時訂為每股新台幣144元。截至八十七年二月二十八日止，此項公司債尚未有轉換為普通股者。



一、業務內容

(一) 營業範圍

本公司專注於「晶圓專業製造服務」之本業，以卓越的製造與服務能力為核心競爭優勢，致力於提供全球半導體廠商極大型及超大型積體電路晶圓製造、晶圓針測、包裝及測試、光罩製作、設計支援服務等全系列的各项服務，其中積體電路晶圓製造佔公司整體營收之九成左右。

過去十年來，我們的客戶已利用本公司的製造服務，生產出各種應用層面的積體電路，涵蓋範圍從電腦、通訊到消費性電子工業等各项領域。據估計，在民國八十六年全球積體電路產品中，大約有3%是透過本公司所提供的服務所產製的。

(二) 主要產品之用途

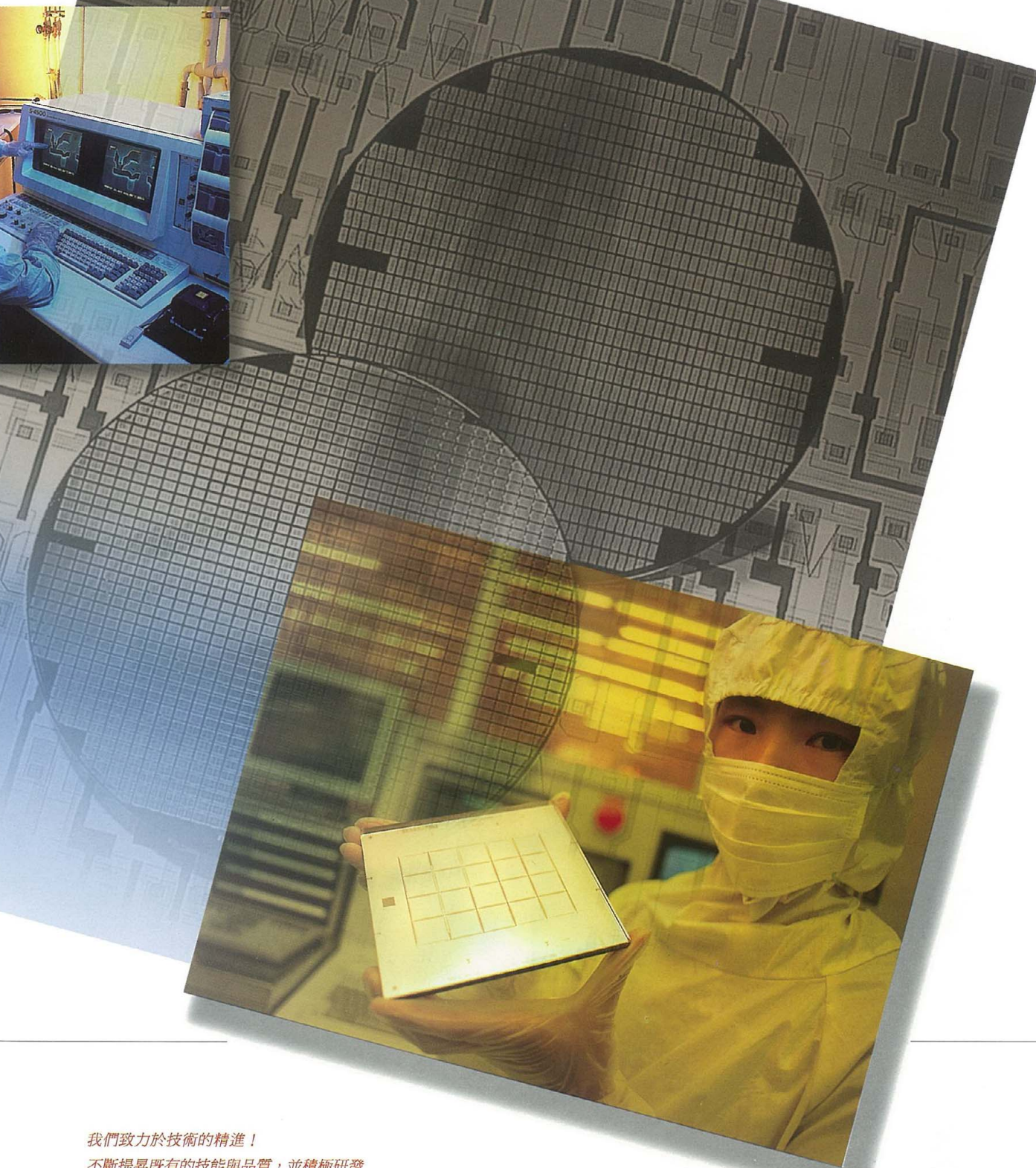
本公司係經由提供整體的晶圓專業製造服務，以協助客戶的產品應用於電腦、通訊、消費性電子產品、汽車及工業設備等各项系統產品之中。

二、市場及行銷

在面臨全球半導體市場低迷，以及晶圓專業製造服務產業競爭者日眾的情形下，本公司在民國八十六年仍締造了營業額新台幣439億及獲利179億元的佳績。來自美國地區客戶的業務佔公司整體營收的42%，國內客戶佔26%，歐洲客戶8%，日本客戶11%，而其他亞洲地區則佔13%。

本公司之所以能有如此優異的表現，首先要歸功於我們與全球客戶建立的緊密夥伴關係，並和部份客戶簽訂了產能預售合約，使本公司能保持穩定的訂單來源。其次，策略運用的正確與組織再造的成功，亦是我們得以持續成長的重要原因。在策略上，本公司一向謹慎控制對記憶體市場的涉入程度，使得本公司得以將記憶體價格滑落的不利影響降至最低。另一方面，基於晶圓專業製造服務市場的競爭逐漸加劇，進入者日眾，為著眼於長期競爭力的培養，我們於民國八十五年就開始投入企業再造，改變組織流程，將過去以生產為導向的組織型態，逐漸改變成以服務為本位、讓技術人才也具有行銷技能的服務型組織，以提高產業的進入障礙，並逐漸實現本公司成為客戶「虛擬晶圓廠」的願景。





我們致力於技術的精進！

不斷提昇既有的技能與品質，並積極研發
新世代的技术，伴隨客戶共同迎向未來。

●最近五年度生產量值表

單位：產能／產量（片，六吋晶圓約當量） 產值（新台幣仟元）

年度	晶圓			包裝元件			其他		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值	產能	產量	產值
82	627,500	664,985	6,282,643	-	-	-	-	-	-
83	915,360	942,617	8,699,044	-	-	-	-	-	-
84	1,158,500	1,217,604	11,507,350	-	-	-	-	-	-
85	1,567,890	1,501,884	16,721,361	-	-	-	-	-	-
86	2,095,760	2,267,675	28,343,668	-	-	-	-	-	-

●最近五年度銷售量值表

單位：量（片，六吋晶圓約當量） 值（新台幣仟元）

年度	晶圓				包裝元件				其他				合計			
	內銷		外銷		內銷		外銷		內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值	量	值
82	218,567	3,583,516	375,863	6,855,705	1,735	70,871	46,546	1,471,238	-	106,408	-	246,185	220,302	3,760,795	422,409	8,573,128
83	282,590	5,526,433	578,784	10,748,451	2,883	99,647	56,356	2,212,963	-	312,873	-	435,704	285,473	5,938,953	635,140	13,397,118
84	342,671	8,540,012	797,501	16,589,558	3,304	139,081	46,131	2,115,917	-	597,449	-	783,974	345,975	9,276,542	843,632	19,489,449
85	439,965	9,735,637	980,386	26,278,058	7,399	378,020	25,497	1,119,274	-	886,343	-	1,002,847	447,364	11,000,000	1,005,883	28,400,179
86	549,337	9,963,659	1,417,494	29,248,555	19,580	806,301	51,531	1,803,038	-	780,892	-	1,333,182	568,917	11,550,852	1,469,025	32,384,775

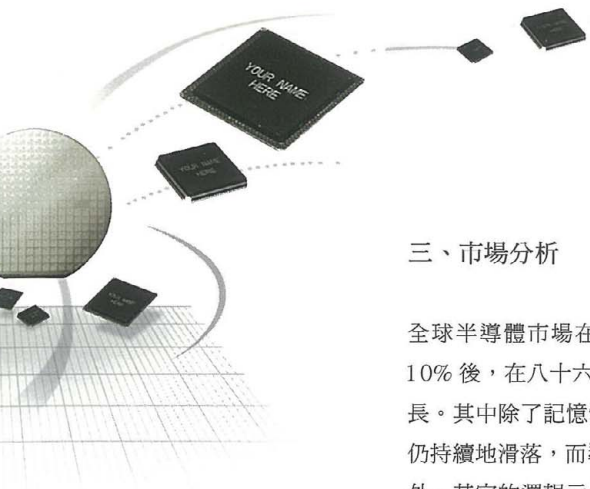


讓天涯近在咫尺

可能您沒注意...

只要您跨出家門，您的"行動"就與電子科技有著密不可分的關係。從汽車到捷運到子彈火車到飛機，先進的電子科技不僅提供您最舒適的行的享受，更縮短地球村的距離，讓天涯近在咫尺！





三、市場分析

全球半導體市場在民國八十五年大幅衰退了10%後，在八十六年即又出現了約5.6%的成長。其中除了記憶體市場因平均每一位元單價仍持續地滑落，而導致市場規模衰退了約13%外，其它的邏輯元件市場則有10%到20%不等的成長。展望未來，民國八十七年全球半導體市場將有約5%至10%左右的成長，其中記憶體市場將隨著新應用的不斷推出而有成長的空間，邏輯元件則將有兩位數的成長。

過去幾年，本公司策略性地控制了投入記憶體市場的程度，務使記憶體製造服務總額不超過公司營業額的一定百分比。這個策略曾在民國八十五年全球記憶體市場近乎自由落體般滑落的情況下，成功地保護本公司得以成長無礙；民國八十六年記憶體市場仍持續衰退，此一策略對本公司的經營產生正面的影響。民國八十七年，本公司在記憶體的市場上，除仍將持續執行「不高於營業額之一定百分比」的策略外，另外亦將針對逐漸成長的嵌入式記憶體應用市場加強技術與客戶的開發。

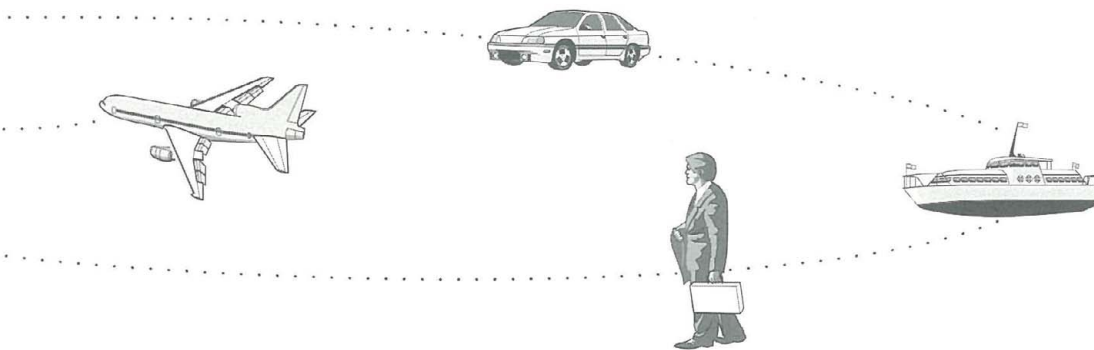
針對邏輯元件，本公司亦將致力於爭取該市場中高成長區隔的客戶。民國八十六年在網際網路、數位消費性電子與無線通訊產業均有新客戶的引進與產品的生產，這些新客戶有些已在民國八十六年對本公司的營運產生相當大的助益，有些則將在未來幾年大量利用本公司的先

進技術與產能。長期而言，將確保本公司未來在晶圓專業製造服務產業中保有高度的成長。

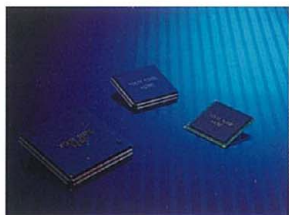
宏觀未來，本公司深信晶圓專業製造服務將在全球半導體產業的生產製造上扮演愈來愈重要的角色。沒有晶圓廠的積體電路設計公司已經仰賴晶圓專業製造服務公司提供積體電路的製造服務，而有晶圓廠的整合元件製造公司也將逐漸增加對晶圓專業製造服務公司的下單。預估到民國八十九年，全球半導體將有15%的產品出自晶圓專業製造服務公司，民國九十五年此一比例更將達20%到25%。

除了全球半導體產業專業分工趨勢明顯的有利因素外，多媒體的興起與低價電腦的風行，也造成晶片整合需求的提昇，增加了客戶對本公司先進技術的需求，有利本公司進行先進技術產能的擴充，並維持平均銷售單價於不墜。

至於對晶圓專業製造服務產業較不利的因素，則是未來可能面臨的激烈競爭壓力。但以本公司在晶圓專業製造服務第一品牌的市場地位，加上堅實的客戶關係及先進的技術與整體服務，本公司應能繼續維持領導地位與獲利能力。



本公司未來將專注於以下先進製造服務技術的提供：



1. 先進的互補金氧半導體邏輯製程

民國八十六年初客戶已成功地運用本公司所提供的0.35微米互補金氧半導體

(CMOS)邏輯製程發展新產品並進行量產，0.3微米技術亦已在八十六年年底進入量產。為緊密配合市場變遷、幫助客戶推出新產品，0.25微米CMOS邏輯製程技術也將在民國八十七年初進入量產，而0.18微米製程則預計於民國八十八年初開始量產。這些先進的製程將為本公司的客戶提供功能更強、整合度更高的生產技術，而使客戶保有在產品性能及成本效益的優勢。

2. 先進的類比／數位訊號製程

在類比／數位訊號的應用市場上，本公司已於民國八十六年初成功開發出0.35微米雙層矽晶、四層金屬製程，並於該年順利進入量產，建立了本公司在資訊傳輸與通訊網路積體電路上獨特的生產服務地位；同時多媒體產品亦需要此一類比／數位混合製程，以利數位訊號處理技術及媒體處理技術的應用。而0.25微米技術則將於民國八十七年初完成。

3. 先進的靜態隨機存取記憶體及嵌入式靜態隨機存取記憶體製程

本公司在民國八十六年已提供0.3微米高速靜態隨機存取記憶體技術供客戶使用，至於0.25微米的技術亦已在八十六年底開發完成，並於八十七年初進入量產。在嵌入式靜態隨機存取記憶體技術方面，本公司則已於民國八十六年底完成0.35微米三層矽晶、四層金屬技術的開發，並隨即進入量產提供給客戶使用。至於0.25微米嵌入式靜態隨機存取記憶體製程則將與0.25微米邏輯製程同時完成。

4. 先進的動態隨機存取記憶體及嵌入式動態隨機存取記憶體製程

本公司已於民國八十六年完成0.32微米動態隨機存取記憶體技術的開發並開始量產，同時0.35微米嵌入式動態隨機存取記憶體技術的開發亦已完成，預計於民國八十七年將可正式提供給客戶使用，協助客戶在影像、資料儲存、通訊應用及數位消費性電子領域中掌握廣大商機。至於0.25微米的動態隨機存取記憶體及嵌入式動態隨機存取記憶體製程，則預計在民國八十八年下半年研發完成。

5. 先進的快閃記憶體及嵌入式快閃記憶體製程
在非揮發性記憶體方面，本公司分別於民國八十六年年中與年底研發完成0.5微米以邏輯電路為主的雙層矽晶、三層金屬、分離式閘極的

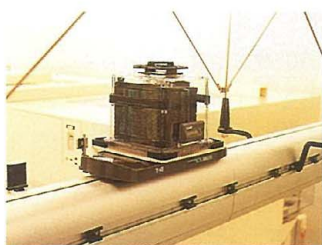


讓資訊跨越國界

只要坐在家裡，彈指之間全世界的資訊任你遨遊！
從企業內部的Intranet到跨越全球的Internet，網際網路讓全球資訊共享成真，更讓豐富的資訊近在咫尺，舉手可得！



嵌入式快閃記憶體技術，與0.5微米類比／數位訊號三層矽晶、三層金屬、分離式閘極的嵌入式快閃記憶體技術。這些製程將提供客戶整合快閃記憶體與邏輯元件於同一晶片上的能力，特別是在需要高度整合的應用上如微控制器、數位訊號處理技術等。另外，0.35微米的快閃記憶體及嵌入式快閃記憶體技術亦預計可在民國八十七年完成研發並進入量產。0.25微米技術則預計在民國八十八年初問市。



6. 雙載子互補式金氧半導體製程

在支援客戶爭取資訊存取與無線通訊市場方面，本公司已於民國八十五年開發出0.8微米雙載子互補式金氧半導體1.2GHz製程供客戶使用。

7. 設計支援服務

本公司0.35微米的標準電路元件庫已於民國八十六年開發完成並為客戶所使用，0.25微米也從民國八十七年第一季開始陸續完成。另外0.25微米的巨集如類比／數位轉換器、鎖相迴路、數位訊號處理器等與0.25微米的设计工具，也將在民國八十七年提供客戶使用，以因應市場上整合性晶片的推出。

四、最近三年度從業員工人數

年度	員工人數				平均 年齡	平均 年資	學歷分佈比率					
	直接 員工	工程類	管理類	合計			博士	碩士	大專	高中	高中 以下	合計
84	1,578	1,372	462	3,412	28	3.3	1.6%	15.3%	38.7%	43.3%	1.1%	100.0%
85	1,830	1,715	572	4,117	28	3.5	1.8%	19.0%	37.8%	41.3%	0.1%	100.0%
86	2,712	2,200	681	5,593	28	3.3	1.8%	20.0%	37.6%	40.5%	0.1%	100.0%



五、轉投資事業

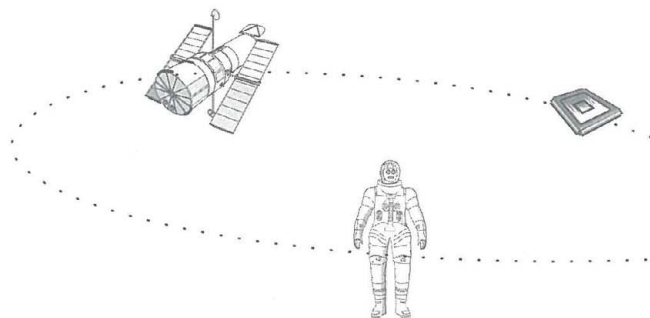
(本資料基準日為86年12月31日)
單位：除投資股份外，均為新台幣仟元

轉投資事業	主要營業範圍	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例%				投資(損)益	分配股利	
台灣光罩股份有限公司	光罩製作	57,032	57,032	6,201,758	4.23	-	895,348	成本法	-	19,247	無
台灣積體電路製造股份有限公司美國子公司	市場行銷及工程支援	25,588	141,485	1,000,000	100.00	141,485	-	權益法	25,129	-	無
台灣積體電路製造股份有限公司歐洲子公司	市場行銷及工程支援	2,960	22,114	200	100.00	22,114	-	權益法	8,820	-	無
台灣積體電路製造股份有限公司日本子公司	市場行銷及工程支援	7,440	6,020	600	100.00	6,020	-	權益法	-	-	無
鑫成科技股份有限公司**	積體電路裝配與測試	494,494	505,394	34,991,651	16.65	538,342	-	成本法	-	16,584	無
世界先進積體電路股份有限公司	積體電路設計製造	5,256,440	5,697,114	520,658,181	27.11	5,499,556	-	權益法	(64,440)	-	無
台積國際投資股份有限公司	半導體相關事業投資	11,045,068	12,489,962	379,788,244	100.00	12,489,962	-	權益法	49,829	-	無
聯亞氣體工業股份有限公司	液氮、氮氣產品製造及銷售業務	146,250	146,250	7,605,000	11.25	124,487	-	成本法	-	17,550	無
台灣信越半導體股份有限公司	矽晶圓產品研發製造及銷售	105,000	105,000	10,500,000	7.00	78,249	-	成本法	-	-	無
普實創業投資股份有限公司	創業投資及相關業務	50,000	50,000	5,000,000	4.17	51,001	-	成本法	-	-	無

** 本公司於87年1月23日，以每股22.54元轉讓持有之鑫成科技公司全部股票計34,991,651股，轉讓金額788,712仟元。

讓人類的視野無限延伸

地球對人類來說很大，對宇宙來說很小！
也就隨著電子天文望遠鏡，星際太空梭乃至於無人登陸小艇，會思考的機器人……電子科技的進步開拓了無數未知領域，更讓人的視野不斷延伸邁進！





六、環境保護措施

民國八十六年本公司之環保工作進行順利。藉著二廠之成功經驗，一廠、三廠及四廠也順利完成了 ISO-14001 的驗證。各廠在環境管理系統體制下，除了確保既有的環保績效得以維持，更進一步展開多項持續改善方案，使污染物的產出更為減少，成本更為降低。而為了將 ISO-14001 之精神擴展至協力廠商，我們在去年更進行問卷調查及現場訪視，實地了解供應商生產過程對環境之影響及其對應措施，並相互交換環保工作經驗，以期將環保力量做更大的發揮。

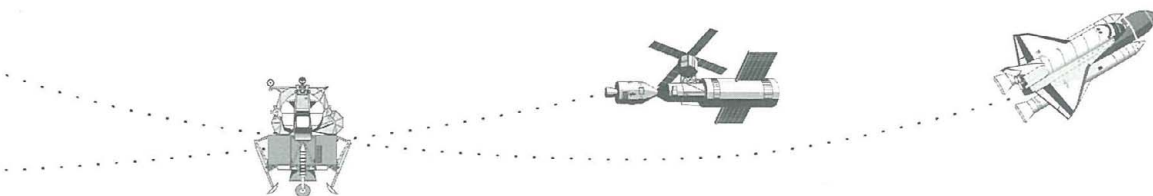
而為了將環保工作推向國際化，本公司之八吋晶圓廠也在去年加入了美國半導體共同研究開發機構--SEMATECH所發起的半導體能源查核計畫，以了解公司能源使用情形，進而比較同業間之差異並尋求改善。查核計畫範圍包括各公司生產機器設備、廠區及辦公區等之用電量；以製程設備為例，選擇耗能、耗水或排氣量較高之數種機台進行代表性量測，其結果除可供工廠做為評估操作狀況之依據，並可做為設備供應商修正機台之參考規範，促使廠商考量機台之節能設計，進而節省工廠電力設施之初設成本。

此外，本公司亦於民國八十六年獲得政府頒發多項環保績優獎，計有由經濟部暨全國工業總會所頒發的「全國防治工業污染暨工業安全衛生績優廠商」獎、由經濟部暨環保署工業減廢聯合輔導小組所頒發的「八十六年度全國工業減廢績優工廠」獎。而公司亦獲行政院環保署頒發「中華民國企業環保獎」之「連續三年績優特別獎」，為半導體同業中首度獲此殊榮者。

七、勞資關係

本公司勞資關係政策致力於營造一個勞資間互信的氣氛，同時重視內部的溝通。因此，主管們都能以尊重的態度來對待自己的員工，勞資關係十分和諧。

為了塑造開放的溝通環境，我們在公司內部設立了許多不同的溝通管道，除了固定之部門月會、員工意見箱及內部刊物「晶圓雜誌」外，還特別開闢了員工諮商輔導室，並視需要辦理座談會及員工意見調查。此外，我們對員工的身心健康也十分重視，從工作環境的改善、休閒活動及設施的設立，以及健康和保險服務的提供，均不遺餘力地強化提昇。



八、重要契約

(一)技術合作契約

(1)契約期間：

民國八十六年七月九日至民國九十六年七月九日

(2)契約內容：

本公司與飛利浦公司簽訂技術合作契約，並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付技術報酬金。

(3)契約對象：

荷蘭商飛利浦電子股份有限公司

(二)次微米技術授權契約

(1)契約期間：

民國七十九年十一月二十日至民國八十九年十二月三十一日

(2)契約內容：

本公司與工研院簽訂次微米技術授權契約，應於五年內支付授權費新台幣壹億貳仟玖佰肆拾萬元(該等權利金已於民國八十四年十二月三十一日前全數支付完畢)，並按約定產品銷貨收入淨額之特定比例支付權利金。

(3)契約對象：

工業技術研究院

(三)房屋及設備租賃契約(一廠)

(1)契約期間：

民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

(2)契約內容：

本公司向經濟部租用約定之房屋及機器設備。

(3)契約對象：

經濟部

(四)土地及公用設施使用借貸契約(一廠)

(1)契約期間：

民國八十六年四月一日至民國九十一年三月三十一日

(2)契約內容：

本公司向工研院租用約定之土地及公用設備。

(3)契約對象：

工業技術研究院

(五)聯貸契約

(1)契約期間：

民國八十三年十二月二十九日至民國九十年十二月十五日

(2)契約內容：

本公司向二十五家銀行貸款共計美金二・六億元，以購買晶圓三廠之設備與機器。

(3)契約對象：

荷蘭銀行台北分行及中國信託商業銀行等二十五家銀行。

(六)產能選擇權契約

(1)契約期間：

民國八十四年至民國九十年

(2)契約內容：

本公司與歐、美、亞洲各地區委製晶圓產品之客戶，簽訂預定未來數年之產能及其選擇權。至民國八十六年底已簽訂之客戶有十餘家。

(3)契約對象：

歐、美、亞洲等地區十餘家公司。



(七)製造契約

(1)契約期間：

自 WaferTech, LLC 量產後起三年

(2)契約內容：

本公司有義務於 WaferTech, LLC 量產後三年內，向 WaferTech, LLC 購買其百分之八十五之產能，本公司亦有權購買其全部產能。若本公司無法購足 WaferTech 之百分之八十五產能，本公司應就未購足部份提出賠償。

(3)契約對象：

WaferTech, LLC

(八)供應契約

(1)契約期間：

自 WaferTech, LLC 量產後起三年

(2)契約內容：

本公司有義務提供且三家客戶有義務購買特定比例之 WaferTech, LLC 產能。若各合約當事人無法供應／購足其承諾之產能，違約者應就未購足部份賠償他方當事人。

(3)契約對象：

三家客戶

九、前各次現金增資或募集公司債計畫尚未完成者之執行情形

本公司於民國八十六年七月三日發行五年期零利率之歐洲可轉換公司債券，以支應新廠興建計畫。此計畫共募得美金三億五千萬元。其中美金154,000 仟元已於八十六年十二月三十一日前全數支用於晶圓四廠製程設備之取得。晶圓五廠製程設備在八十六年底前則已支用美金152,580 仟元，完成工程進度之81.6%。所餘資金預計於八十七年第二季前全數用於五廠製程設備之購買。

十、訴訟事件

美商美光公司 (Micron Technology Inc.) 於民國八十六年二月對韓國及台灣輸美之靜態隨機存取記憶體 (SRAMs) 提出傾銷控訴。商務部已於八十七年二月十三日公佈其終局判定之傾銷稅率。本公司因遭認定為非生產商，故適用平均稅率，即41.98%。美國國際貿易調查委員會則預定於八十七年四月作出美國產業是否受到傷害或有受傷害之虞的最終判決。因SRAM佔本公司銷售比例極為有限，且本公司直接輸美之SRAM數量更少，預估對本公司無重大影響。

我們擁有無限的彈性！

對於客戶的需求，我們總是以客戶自己的心情，全力配合，不分晝夜，讓客戶感覺就像在運作自己的晶圓廠一般，得心應手。





一、八十七年度增資擴充計畫

●八十七年度資本支出之計畫內容及預計產生效益

項目	金額（新台幣佰萬元）	預計產生之效益
晶圓七廠建廠規劃	495	預計於 89 年開始生產 12 吋晶圓
晶圓六廠廠房興建	11,411	預計於 88 年中開始生產 8 吋晶圓
晶圓五廠廠房擴充	15,966	預計於 87 年底可達月產 8 吋晶圓 22,000 片
晶圓四廠產能擴充	6,662	預計於 87 年底可達月產 8 吋晶圓 31,000 片
晶圓三廠產能擴充	3,739	預計於 87 年底可達月產 8 吋晶圓 41,000 片
二廠模組 B 及南廠電子束作業 產能擴充	644	維持技術優勢，提昇競爭能力
設備汰舊換新及其他	3,977	維持技術優勢，提昇競爭能力
合計	\$42,894	

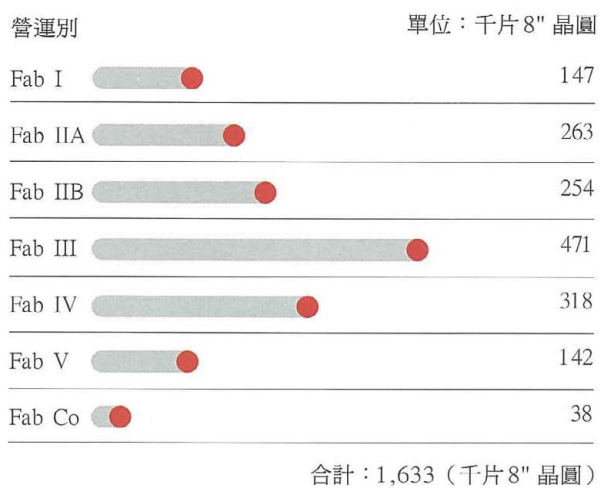
資金來源將由自有資金及銀行貸款共同支應。

我們的未來無限寬廣！

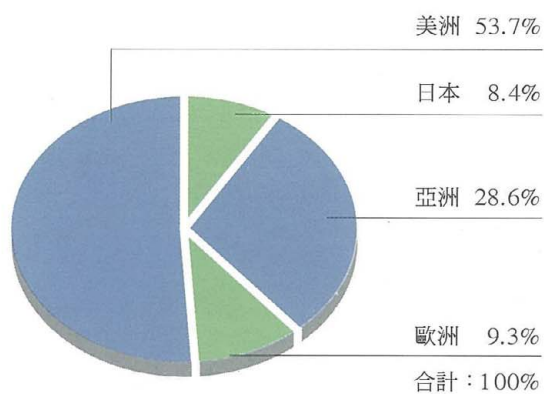
我們將以前瞻未來的眼光，不斷超越的心情，
持續研發創新，成為晶圓專業製造服務領域中永
遠的領導者。

二、八十七年度產銷計畫

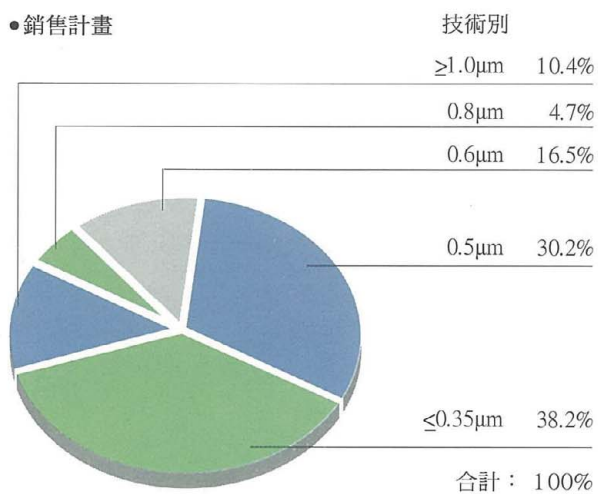
●生產計畫



●各地區淨銷售額比例



●銷售計畫



三、研究發展計畫

(一) 最近三年度研究發展費用及成果

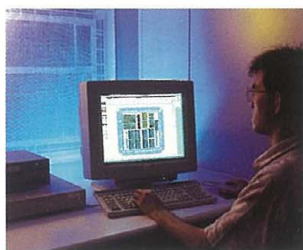
● 積體電路製程研發支出



● 研發成果

本公司的研究發展組織是半導體業中最優秀的研發團隊之一，它擁有豐富的邏輯、記憶體、先進製程模組、電腦輔助設計及光罩技術等各項工程資源。本組織在製程技術的研發上，不僅領先其他晶圓專業製造服務公司，更致力於成為全球積體電路產業中的領導者。

民國八十六年本公司成功地發展出0.25微米五層金屬邏輯製程技術，由於其在元件特性及後端金屬製程準則的優異表現，在剛推出的前幾個月便吸引了破紀錄的客戶使用。同時，我們



也開發完成了下列記憶體製程技術：在靜態隨機存取記憶體方面，我們的0.25微米四個電晶體製程，可以製作出全世界面積最小的產品，使得每一片晶圓的晶粒產出量增加30%，協助客戶降低成本。其次，我們的0.35微米嵌入式靜態隨機存取記憶體製程技術，能夠讓客戶在邏輯晶片上嵌入四百萬位元的靜態隨機存取記憶體，是全球目前可嵌入之靜態隨機存取記憶體中容量最大的。在嵌入式動態隨機存取記憶體方面，0.35微米製程也成功地完成了單晶系統晶片(system-on-a-chip)，如結合高階繪圖晶片和十六百萬位元動態隨機存取記憶體在單一晶片上的試製。另外，我們的0.35微米嵌入式快閃記憶體，結合非揮發性記憶體和高性能邏輯晶片，更開啟了通往先進的微控制器以及多重附加功能通訊產品之路。

(二) 未來研發方向

本公司一直致力於更先進的新世代製程技術之研發，並在生產線上大量為客戶提供製造服務。目前正在研發的製程技術包括：0.18微米邏輯、0.25微米類比/數位訊號、0.18微米靜態隨機存取記憶體、0.25微米快閃記憶體，以及0.25微米嵌入式動態隨機存取記憶體等。

在新的年度中，本公司將繼續增加研究發展投資經費，開發更新一代的銅製程0.15微米技術。本公司對於研發之投入不僅能提供及時的先進技術，更能給予客戶在新產品導入市場時強有力的競爭優勢。

財務資料

一、簡明資產負債表
最近五年度財務資料

單位：新台幣仟元

項目	82年	83年	84年	85年	86年
流動資產	5,111,310	7,659,444	16,070,964	16,529,359	23,790,795
長期股權投資	161,156	3,074,147	4,989,037	12,608,506	19,220,371
固定資產	10,436,047	14,986,932	26,643,665	41,978,952	61,697,723
其他資產	290,639	386,580	599,369	2,018,827	3,804,923
流動負債					
分配前	2,046,034	2,897,189	5,075,481	5,357,895	10,088,672
分配後	2,789,825	3,233,580	5,926,696	5,926,138	*
長期借款	2,546,644	3,259,206	5,556,381	5,720,000	20,009,357
其他負債	305,373	1,119,880	4,091,928	9,943,809	9,001,390
股本	6,083,040	7,800,000	14,390,000	26,542,000	40,813,000
資本公債	822	875	19,428	59,086	62,082
保留盈餘					
分配前	5,016,046	11,029,256	19,165,640	25,523,456	28,641,292
分配後	2,555,295	4,102,865	6,162,425	10,684,213	*
資產總額	15,999,151	26,107,103	48,303,035	73,135,644	108,513,812
負債總額					
分配前	4,898,050	7,276,275	14,723,790	21,021,704	39,099,419
分配後	5,641,841	7,612,666	15,575,005	21,589,947	*
股東權益總額					
分配前	11,101,101	18,830,828	33,579,245	52,113,940	69,414,393
分配後	10,357,310	18,494,437	32,728,030	51,545,697	*

*俟股東會決議後定案

二、簡明損益表
最近五年度財務資料

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘：新台幣元)

項目	82年	83年	84年	85年	86年
銷貨收入	12,333,923	19,336,071	28,765,991	39,400,179	43,935,627
銷貨毛利	5,410,167	10,091,902	16,104,950	21,979,249*	21,094,156
營業損益	4,419,143	8,615,119	13,897,006	18,235,246	15,489,780
利息收入	55,269	210,135	367,986	653,462	501,434
利息費用	180,412	197,062	258,000	277,161	546,490
稅前損益	4,245,106	8,580,744	14,314,528	18,972,932	15,517,103
稅後損益	4,245,106	8,474,014	15,081,273	19,400,689	17,960,075
每股盈餘	6.98**	10.86**	10.48**	7.31**	4.40**
	1.04***	2.08***	3.70***	4.75***	
利息支出資本化	27,467	15,868	102,926	181,168	255,054

*84及85年度損益表資料若干科目經予重新分類，俾配合86年度財務報表之表達。

**按各年度流通在外加權平均股數計算之每股盈餘。

***按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

三、財務分析
最近五年度財務資料

項目	82年	83年	84年	85年	86年
財務結構					
負債佔資產比率(%)	30.61	27.87	30.48	28.74	36.03
長期資金佔固定資產比率(%)	130.78	147.40	146.89	137.77	144.94
償債能力					
流動比率(%)	249.82	264.38	316.64	308.50	235.82
速動比率(%)	189.88	214.33	257.83	247.77	185.78
利息保障倍數(次)	21.29	41.22	40.38	42.40	20.04
經營能力					
應收帳款週轉率(次)	7.51	8.55	8.12	8.80	6.22
應收帳款收現日數	48.60	42.69	44.95	41.00	58.68
存貨週轉率(次)	7.40	8.01	7.73	7.24*	6.12
平均售貨日數	49.32	45.57	47.22	50.43*	59.69
固定資產週轉率(次)	1.18	1.29	1.08	0.94	0.71
總資產週轉率(次)	0.77	0.74	0.60	0.54	0.41
獲利能力					
資產報酬率(%)	32.31	41.17	41.23	32.40	20.35
股東權益報酬率(%)	46.74	56.62	57.55	45.28	29.56
營業利益佔實收資本比率(%)	72.65	110.45	96.57	68.70	37.95
稅前純益佔實收資本比率(%)	69.79	110.01	99.48	71.48	38.02
純益率(%)	34.42	43.82	52.43	49.24	40.88
每股淨值(元)	18.25	24.14	23.34	19.63	17.01
每股盈餘(元)	1.04**	2.08**	3.70**	4.75**	4.40
每股股利(元)	3.48	8.00	8.00	5.00	***
現金股利(元)	1.00	-	-	-	***
股票股利(元)	2.48	8.00	8.00	5.00	***
現金流量					
現金流量比率(%)	299.84	394.12	348.45	452.74	201.55
現金流量允當比率(%)	69.78	103.20	111.94	113.70	97.96
現金再投資比率(%)	31.59	34.34	31.94	28.21	16.28
槓桿度					
營業槓桿度	2.08	1.70	1.69	1.79	2.15
財務槓桿度	1.04	1.02	1.02	1.02	1.04

*85年度損益表資料若干科目經予重新分類，俾配合86年度財務報表之表達。

**按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘。

***俟股東會決議後定案。

四、每股淨值、盈餘、股利及市價

單位：除加權平均股數及投資報酬分析外，均為新台幣元

	84年	85年	86年
每股市價			
最高	196.00	106.00	173.00
最低	77.00	49.10	55.5
平均	128.43	63.83	109.35
每股淨值			
分配前	23.34	19.63	17.01
分配後	22.74	19.42	*
每股盈餘			
加權平均股數	1,439,000,000	2,654,200,000	4,081,300,000
每股盈餘	10.48	7.31	4.40
每股盈餘 ¹	3.70	4.75	
每股股利			
現金股利	-	-	*
無償配股			
盈餘配股	8.00	5.00	*
資本公積配股	-	-	*
投資報酬分析			
本益比 ²	12.25	8.73	24.85
本利比 ³	-	-	*
現金股利殖利率 ⁴	0	0	*

*俟股東會決議後定案

註1:按盈餘轉增資比率及員工紅利配股比率，追溯調整後之每股盈餘

註2:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘

註3:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利

註4:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價

五、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師姓名	查核意見
82年	張銘政、蔡紹禧	無保留意見
83年	黃樹傑、蔡紹禧	無保留意見
84年	黃樹傑、魏永篤	除採用二十二號公報外，其餘為無保留意見
85年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見
86年	黃樹傑、魏永篤	無保留意見

台北市民生東路3段156號12樓 電話：886-2-2545-9988

六、監察人審查報告書

董事會造送本公司八十六年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產之財產目錄及盈餘分派議案等，其中資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表、主要財產之財產目錄業經委託勤業會計師事務所查核完竣，並出具財務報告。上述表冊及報告經本監察人等審查，認為尚無不合，爰依公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

本公司八十七年股東常會

台灣積體電路製造股份有限公司

監察人 歐盛



監察人 胡仲英



監察人 胡新南



中華民國八十七年三月十三日

七、財務報表暨會計師查核報告書

台灣積體電路製造股份有限公司民國八十六年及八十五年十二月三十一日之資產負債表，暨民國八十六年及八十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則，採用必要之查核程序，包括各項會計記錄之抽查在內，予以查核竣事。

據本會計師之意見，第一段所述財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則於前後一致之基礎上編製，足以公正表示台灣積體電路製造股份有限公司民國八十六年及八十五年十二月三十一日之財務狀況，暨民國八十六年度及八十五年度之營業成績及現金流量。

台灣積體電路製造股份有限公司已編製民國八十六年度及八十五年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此致

台灣積體電路製造股份有限公司 公鑒

勤業會計師事務所

會計師 黃樹傑



台灣省會計師公會會員證第1723號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(83)台財證(六)第12213號

中華民國八十七年二月四日

會計師 魏永篤



台灣省會計師公會會員證第705號
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
(72)台財證(一)第2583號

中華民國八十七年二月四日

資產負債表

民國八十六年及八十五年十二月三十一日
單位：除每股面額外，為新台幣仟元

資產	八十六年底		八十五年底	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金(附註二及三)	\$ 2,534,242	2	\$ 8,692,448	12
短期投資(附註二及四)	4,970,832	5	-	-
應收關係人款項(附註十四)	503,040	-	351,889	1
應收票據	234,912	-	121,176	-
應收帳款	9,634,203	9	4,719,791	6
備抵呆帳(附註二)	(293,087)	-	(155,627)	-
備抵退貨及折讓(附註二)	(535,214)	-	(454,290)	(1)
存貨(附註二及五)	4,720,031	4	2,750,536	4
遞延所得稅資產(附註二及十三)	667,228	1	74,000	-
預付費用及其他流動資產(附註十四)	1,354,608	1	429,436	1
流動資產合計	23,790,795	22	16,529,359	23
長期股權投資(附註二及六)	19,220,371	18	12,608,506	17
固定資產(附註二、七及十五)				
成本				
建築物	18,125,783	17	9,768,555	13
機器設備	64,525,249	59	35,073,892	48
辦公設備	791,462	1	654,723	1
	83,442,494	77	45,497,170	62
累積折舊	(26,502,409)	(24)	(18,225,695)	(25)
預付款項及未完工程	4,757,638	4	14,707,477	20
固定資產淨額	61,697,723	57	41,978,952	57
其他資產				
遞延借項－淨額(附註二)	641,989	-	140,446	-
遞延所得稅資產(附註二及十三)	3,080,099	3	1,744,263	3
存出保證金(附註十六)	73,585	-	124,868	-
其他	9,250	-	9,250	-
其他資產合計	3,804,923	3	2,018,827	3
資產總計	\$108,513,812	100	\$73,135,644	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

負債及股東權益	八十六年底		八十五年底	
	金額	%	金額	%
流動負債				
應付商業本票(附註八)	\$ 250,000	-	\$ -	-
應付關係人款項(附註十四)	794,313	1	453,098	1
應付帳款	2,660,146	2	1,034,518	1
應付工程及設備款	4,965,985	5	2,565,527	4
應付所得稅(附註二及十三)	-	-	447,780	-
應計費用及其他流動負債	<u>1,418,228</u>	<u>1</u>	<u>856,972</u>	<u>1</u>
流動負債合計	10,088,672	9	5,357,895	7
長期借款(附註七及九)	8,025,900	7	5,720,000	8
應付公司債(附註十)	11,983,457	11	-	-
應計退休金負債(附註二及十二)	487,705	1	328,729	-
其他負債(附註十六)				
存入保證金	8,513,685	8	8,819,322	12
預收設備款	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>795,758</u>	<u>1</u>
負債合計	<u>39,099,419</u>	<u>36</u>	<u>21,021,704</u>	<u>28</u>
股東權益				
股本—每股面額10元，額定八十六年8,500,000仟股，八十五年3,000,000仟股；發行—八十六年4,081,300仟股，八十五年2,654,200仟股	40,813,000	38	26,542,000	37
資本公積	62,082	-	59,086	-
法定公積	4,928,532	4	2,992,429	4
未分配盈餘	23,712,760	22	22,531,027	31
累積換算調整數(附註二)	<u>(101,981)</u>	<u>-</u>	<u>(10,602)</u>	<u>-</u>
股東權益合計	<u>69,414,393</u>	<u>64</u>	<u>52,113,940</u>	<u>72</u>
負債及股東權益總計	<u>\$108,513,812</u>	<u>100</u>	<u>\$73,135,644</u>	<u>100</u>

損 益 表

民國八十六年及八十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十六年度		八十五年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額(附註十四)	\$44,765,428		\$39,836,725	
銷貨退回及折讓	(829,801)		(436,546)	
銷貨收入淨額	43,935,627	100	39,400,179	100
銷貨成本(附註十四)	22,841,471	52	17,420,930	44
銷貨毛利	21,094,156	48	21,979,249	56
營業費用				
管理費用	1,583,228	4	1,597,461	4
行銷費用(附註十四)	1,515,845	3	652,543	1
研究發展費用	2,505,303	6	1,493,999	4
合計	5,604,376	13	3,744,003	9
營業利益	15,489,780	35	18,235,246	47
營業外收入				
利息收入	501,434	1	653,462	2
按權益法認列之投資收益(附註二及六)	17,804	-	156,152	-
處分長期股權投資利益	311,453	1	39,668	-
處分固定資產利益	3,131	-	40,759	-
兌換淨益(附註二)	-	-	107,398	-
其他收入	23,891	-	27,542	-
合計	857,713	2	1,024,981	2
營業外費用				
利息費用(附註七)	546,490	1	277,161	1
兌換淨損(附註二)	188,884	1	-	-
公司債發行成本	66,361	-	-	-
處分固定資產損失	7,722	-	10,071	-
其他損失	20,933	-	63	-
合計	830,390	2	287,295	1
稅前利益	15,517,103	35	18,972,932	48
所得稅利益(附註二及十三)	2,442,972	6	427,757	1
純益	\$17,960,075	41	\$19,400,689	49
每股盈餘				
—按加權平均發行股數八十六年4,081,300仟股及八十五年2,654,200仟股計算	\$4.40		\$7.31	
—按4,081,300仟股計算			\$4.75	

股東權益變動表

民國八十六年及八十五年一月一日至十二月三十一日
單位：新台幣仟元

33

財務資料

	發行股本		資本公積(附註二)			保留盈餘(附註十一)			累積換算調整數	
	股數 (仟股)	金額	處分固定 資產利益	捐贈	合計	法定公積	未分配盈餘	合計	整數 (附註二)	合計
民國八十五年初餘額	1,439,000	\$14,390,000	\$19,373	\$55	\$19,428	\$1,486,151	\$17,679,489	\$19,165,640	\$ 4,177	\$33,579,245
盈餘分配										
法定公積	-	-	-	-	-	1,506,278	(1,506,278)	-	-	-
員工紅利										
－現金	-	-	-	-	-	-	(715,650)	(715,650)	-	(715,650)
－股票	64,000	640,000	-	-	-	-	(640,000)	(640,000)	-	-
股票股利－80%	1,151,200	11,512,000	-	-	-	-	(11,512,000)	(11,512,000)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(135,565)	(135,565)	-	(135,565)
民國八十五年度純益	-	-	-	-	-	-	19,400,689	19,400,689	-	19,400,689
處分固定資產利益轉 列資本公積	-	-	39,658	-	39,658	-	(39,658)	(39,658)	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(14,779)	(14,779)
民國八十五年底餘額	2,654,200	26,542,000	59,031	55	59,086	2,992,429	22,531,027	25,523,456	(10,602)	52,113,940
盈餘分配										
法定公積	-	-	-	-	-	1,936,103	(1,936,103)	-	-	-
員工紅利										
－現金	-	-	-	-	-	-	(393,994)	(393,994)	-	(393,994)
－股票	100,000	1,000,000	-	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)	-	-
股票股利－50%	1,327,100	13,271,000	-	-	-	-	(13,271,000)	(13,271,000)	-	-
董監事酬勞	-	-	-	-	-	-	(174,249)	(174,249)	-	(174,249)
民國八十六年度純益	-	-	-	-	-	-	17,960,075	17,960,075	-	17,960,075
處分固定資產利益轉 列資本公積	-	-	2,996	-	2,996	-	(2,996)	(2,996)	-	-
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	(91,379)	(91,379)
民國八十六年底餘額	4,081,300	\$40,813,000	\$62,027	\$55	\$62,082	\$4,928,532	\$23,712,760	\$28,641,292	(\$101,981)	\$69,414,393

現金流量表

民國八十六年及八十五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣仟元

	八十六年度	八十五年度
營業活動之現金流量：		
純益	\$17,960,075	\$19,400,689
折舊及攤銷	9,762,544	6,539,199
遞延所得稅資產	(1,929,064)	(903,872)
按權益法認列之投資收益	(17,804)	(156,152)
處分長期股權投資利益	(311,453)	(39,668)
處分固定資產淨損(益)	9,526	(18,726)
應付利息補償金	433,457	-
其他	-	(129)
營業資產及負債科目之變動		
應收關係人款項	(151,151)	(99,093)
應收票據	(113,736)	18,770
應收帳款	(4,914,412)	(135,917)
備抵呆帳	137,460	(1,000)
備抵退貨及折讓	80,924	4,996
存貨	(1,969,495)	(687,494)
預付費用及其他流動資產	(970,741)	(92,653)
應付關係人款項	341,215	(143,057)
應付帳款	1,687,186	(629,752)
應付所得稅	(447,780)	277,201
應計費用及其他流動負債	588,188	(195,358)
應計退休金負債	158,976	117,954
營業活動之淨現金流入	<u>20,333,915</u>	<u>23,255,938</u>
投資活動之現金流量：		
短期投資增加	(4,970,832)	-
購置固定資產	(28,020,842)	(20,932,942)
長期股權投資增加	(5,245,762)	(7,537,209)
處分固定資產價款	38,256	67,960
處分長期股權投資價款	341,786	114,651
遞延借項增加	(607,028)	(128,712)
存出保證金減少	45,531	91,184
投資活動之淨現金流出	<u>(38,418,891)</u>	<u>(28,325,068)</u>
理財活動之現金流量：		
應付商業本票增加	250,000	-
發行公司債	11,550,000	-
舉借長期借款	2,877,900	6,868,841
償還長期借款	(572,000)	(6,705,222)
員工紅利	(393,994)	(715,650)
董監事酬勞	(174,249)	(135,565)
預收機器設備款增加	163,780	356,462
存入保證金增加(減少)	(305,637)	5,377,465
應付遠匯款調整數	(1,469,030)	-
理財活動之淨現金流入	<u>11,926,770</u>	<u>5,046,331</u>
現金及約當現金淨減少	<u>(6,158,206)</u>	<u>(22,799)</u>
年初現金及約當現金餘額	8,692,448	8,715,247
年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,534,242</u>	<u>\$ 8,692,448</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息(不含資本化利息)	\$ 477,643	\$ 331,848
支付所得稅	-	\$ 198,908
不影響現金流量之投資及理財活動		
匯率影響數	\$ 43,774	\$ 40,975
購置固定資產價款	\$30,421,300	\$21,890,452
應付工程及設備款	(2,400,458)	(957,510)
支付淨額	<u>\$28,020,842</u>	<u>\$20,932,942</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(一)公司沿革

本公司係由行政院開發基金管理委員會及荷蘭商飛利浦電子股份有限公司(飛利浦公司)等共同投資設立。本公司股票於台灣證券交易所上市。八十六年十月八日，本公司部份已發行之股票以美國存託憑證方式於紐約證券交易所上市。

本公司主要業務為有關積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、封裝測試與電腦輔助設計，暨光罩之製造及設計服務。

(二)重要會計政策之彙總說明**■ 約當現金**

約當現金係指自投資日起三個月內到期之商業本票及可轉讓定存單。

■ 短期投資

短期投資係指債券，按成本與市價孰低計價。

出售成本則採個別辨認。

■ 備抵呆帳

係按應收款項收回之可能性評估認列。

■ 銷貨收入及備抵退貨及折讓

銷貨收入係於貨物移轉時認列，備抵退貨及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售年度列為銷貨之減項。

■ 存貨

存貨係以成本與市價孰低計價。存貨平時按標準成本計價，結帳日時再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。市價之決定，原料、物料及零件係以重置成本為準，在製品及製成品則以淨變現價值為準。

■ 長期股權投資

本公司持有股權比例達百分之二十以上且具有重大影響力之長期股權投資，係採用權益法計價；原始投資成本與取得股權時被投資公司股權淨值間之差額，係採直線法分五年平均攤銷，並列為投資損益。當國外子公司之功能性貨幣為外幣時，其外幣財務報表換算後所產生之兌換差額列為股東權益項下之「累積換算調整數」。

本公司持有股權比例未達百分之二十之長期股權投資，係按成本法計價。

股票出售時，其成本係按加權平均法計算。

■ 固定資產

重大之增添、更新及改良列為資本支出，修理及維護支出，則列為當年度費用。固定資產於購建期間支出款項所負擔之利息予以資本化。

折舊係以直線法按下列耐用年數計提：建築物，十至二十年；機器設備，五至十年；辦公設備，三至五年。

固定資產報廢或出售時，其成本及相關之累積折舊均自帳上予以減除，出售及處分之損失或利益列為當年度損益。出售利益扣除有關所得稅後之淨額再於當年底轉列資本公積。

■ 遞延借項

遞延借項主要係電腦軟體制度設計費用及海外可轉換公司債發行成本，分別按三及五年攤銷。

■ 員工退休金

本公司按精算結果認列退休金費用，另精算結果之未認列過渡性淨給付義務係按二十五年攤提。

■ 所得稅

本公司所得稅之會計處理係作跨期間之所得稅分攤，即將可減除暫時性差異、未使用以前年度虧損扣抵及投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列相關備抵評價金額；而應課稅暫時性差異所產生之影響數認列為遞延所得稅負債。

以前年度應付所得稅之調整，列為當年度所得稅。

■ 衍生性金融商品交易

為規避外幣淨資產或淨負債之匯率風險之遠期外匯買賣合約，於訂約日以該日之即期匯率衡量入帳。訂約日即期匯率與約定遠期匯率間之差額於合約期間攤銷，應收或應付遠期外匯期末餘額，再按期末之即期匯率調整，所產生之兌換差額，列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額於資產負債表中互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

為規避外幣承諾之匯率風險者，兌換損益及溢折價遞延至實際交易發生時，調整交易價格。

為規避國外企業淨投資之匯率風險者，兌換損益及溢折價作為股東權益之調整項目。

非以交易為目的之遠期利率合約，於簽約日因無本金移轉，僅作備忘記錄，於約定結算日及資產負債表日就合約利率與市場實際利率所計得之應收或應付金額，作為被避險資產或負債有關之利息收入或利息費用之調整。

■ 以外幣為準之交易事項

非衍生性金融商品之外幣交易，係按交易當日匯率折算之新台幣金額入帳。外幣現金實際兌換成新台幣或外幣應收應付款以新台幣收付結清時，因適用不同匯率所產生之損失或盈益，列為兌換或結清年度之損益。外幣現金、資產及負債之年底餘額，按期末時之匯率予以換算，因而產生之兌換損益，則列為當期損益。

■ 科目重分類

八十五年度財務報表若干科目經予重新分類，俾配合八十六年度財務報表之表達。

(三)現金及約當現金

	八十六年底	八十五年底
現金及銀行存款	\$1,942,051	\$8,461,166
商業本票	344,434	231,282
可轉讓定存單	247,757	-
	<u>\$2,534,242</u>	<u>\$8,692,448</u>

(四)短期投資

	八十六年底	八十五年底
美國政府債券	\$4,582,672	\$ -
外國公司債	388,160	-
	<u>\$4,970,832</u>	<u>\$ -</u>

(五)存貨

	八十六年底	八十五年底
製成品	\$ 521,950	\$ 247,124
在製品	2,539,137	1,175,727
原料	1,028,528	782,754
物料及零件	737,216	619,423
	4,826,831	2,825,028
備抵存貨損失	(106,800)	(74,492)
	<u>\$4,720,031</u>	<u>\$2,750,536</u>

(六)長期股權投資

	八十六年底		八十五年底	
	帳列金額	持股比例%	帳列金額	持股比例%
按權益法計價				
台積國際投資公司	\$12,489,962	100	\$ 6,176,879	100
世界先進積體電路公司	5,697,114	27	5,762,964	27
台灣積體電路(美國)公司	141,485	100	95,224	100
台灣積體電路(歐洲)公司	22,114	100	12,299	100
台灣積體電路(日本)公司	6,020	100	-	-
	<u>18,356,695</u>		<u>12,047,366</u>	
按成本法計價				
台灣光罩公司(上市公司)	57,032	4	55,988	8
鑫成科技公司	505,394	17	203,902	18
聯亞氣體工業公司	146,250	11	146,250	11
台灣信越半導體公司	105,000	7	105,000	7
普實創業投資公司	50,000	4	50,000	13
	<u>863,676</u>		<u>561,140</u>	
	<u>\$19,220,371</u>		<u>\$12,608,506</u>	

本公司八十六及八十五年度按權益法認列之投資收益分別計17,804仟元及156,152仟元，除台灣積體電路(日本)公司財務報表未達會計師查核簽證標準外，係依各該公司同期間經會計師查核之財務報表計算。

長期股權投資採用成本法計價者，其有關股票市價及淨值之資料如下：

	八十六年底	八十五年底
上市公司股票市價	\$895,348	\$651,260
未上市上櫃公司持股之淨值	792,079	463,681
本公司於八十七年一月二十三日，以每股22.54元轉讓持有之鑫成科技公司全部股票計34,991 仟股，轉讓金額788,712仟元。		

(七)固定資產

累積折舊如下：

	八十六年底	八十五年底
建築物	\$ 3,686,442	\$ 2,408,179
機器設備	22,387,187	15,486,317
辦公設備	<u>428,780</u>	<u>331,199</u>
	<u>\$26,502,409</u>	<u>\$18,225,695</u>

截至八十六年底止，本公司擴建積體電路廠房及設備計畫如下：

擴廠計劃名稱	預計總投資金額	累積支出金額	預訂或實際生產年月
積體電路第六廠	\$22,750,000	\$1,007,638	88.7

八十六及八十五年度利息資本化金額分別為255,054仟元及181,168仟元。

截至八十六年底止，帳列未折減餘額計4,749,145仟元之固定資產業已抵押作為長期借款之擔保品。

(八)應付商業本票

應付商業本票係由票券金融公司保證，八十七年三月到期，年利率8.4%。

截至八十六年底止，本公司尚未使用之商業本票額度為250,000仟元。

(九)長期借款

	八十六年底	八十五年底
美金銀行借款：		
八十六年及八十五年餘額分別為美金156,000仟元及208,000仟元，自八十六年六月起每半年償還，至九十年十二月還清，年利率八十六年為7.03%，八十五年為6.63%~6.83%。	\$5,148,000	\$5,720,000
美金36,300仟元，分別至八十八年十月前還清，年利率為5.96%~6.56%。	1,197,900	-
新台幣銀行借款：		
應付承兌票據一分別至八十九年十月前還清，年利率為8.25%~8.50%。	1,680,000	-
	<u>\$8,025,900</u>	<u>\$5,720,000</u>

截至八十六年底止，本公司尚未使用之借款額度為5,489,570仟元。

(十)應付公司債

本公司於八十六年七月三日發行海外第一次有擔保可轉換公司債美金350,000仟元(折合新台幣11,550,000仟元)，票面年利率0%，本金及利息補償金計433,457仟元於九十一年七月三日期時一次償還。依轉換辦法規定，轉換價格於發行時訂為每股144元(嗣後則依公式調整)，債權人於發行之日起滿四十天後至到期前五日止，得依規定請求轉換為本公司換股權利證書；當分別符合特定條件時，公司債持有人得享有債券賣回權，本公司得享有債券贖回權。截至八十六年底止，此項公司債尚未有轉換為普通股者。

(十一)股東權益

依據公司法之規定，資本公積只能用於彌補虧損或撥充股本。

依據本公司章程規定，每年度純益於彌補虧損後，應分配如下：

- 1.先提撥百分之十為法定公積；
- 2.次提其餘額百分之一為董監事酬勞，及不低於百分之一為員工紅利；
- 3.剩餘部分依股東會決議分派之。

上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認，並於該年度入帳。

依公司法之規定，法定公積應繼續提撥至其總額達股本總額為止。法定公積得用以彌補虧損；且當該項公積已達實收股本百分之五十時，亦得以其半數撥充股本。

(十二)員工退休金

本公司對正式員工訂有退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休時之平均薪資計算。本公司每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休基金，交由職工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入中央信託局之專戶。

本公司退休金相關資訊揭露如下：

八十六年度淨退休金成本為：

服務成本	\$198,503
利息成本	50,564
退休基金資產預期報酬	(12,875)
攤銷數	8,300
淨退休金成本	<u>\$244,492</u>

八十六年度認列之退休金費用計204,800仟元。

退休基金提撥狀況與帳載應計退休金負債之調節如下：

	八十六年底	八十五年底
給付義務		
既得給付義務	\$ 446	\$ -
非既得給付義務	260,849	165,686
累積給付義務	261,295	165,686
未來薪資增加之影響數	729,989	556,663
預計給付義務	991,284	722,349
退休基金資產公平價值	(212,851)	(157,873)
提撥狀況	778,433	564,476
未認列前期服務成本	-	-
未認列過渡性淨給付義務	(190,891)	(199,191)
未認列退休金損失	(55,914)	(33,557)
補列之退休金負債	-	-
應計退休金負債	<u>\$ 531,628</u>	<u>\$ 331,728</u>

退休金給付義務及計算退休金成本之假設為：

折現率	7%	7%
未來薪資水準增加率	7%	7%
退休基金資產預期投資報酬率	7%	7%

退休金提撥及支付情況

本期提撥	<u>\$ 44,747</u>	<u>\$ 36,461</u>
本期支付	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(十三)所得稅

	八十六年度	八十五年度
按法定稅率(20%)計算之稅額	\$3,103,421	\$3,794,586
免稅所得減付之稅額	(2,432,733)	(2,761,632)
其他	(5,688)	(5,229)
本期應負擔稅額	665,000	1,027,725
所得稅抵減	(665,000)	(513,863)
本期應付	-	513,862
遞延所得稅資產投資抵減淨變動	(2,579,214)	(1,623,872)
遞延所得稅備抵評價調整數	650,150	720,000
以前年度所得稅調整	(513,908)	(37,747)
所得稅利益	<u>(\$2,442,972)</u>	<u>(\$427,757)</u>

截至八十六年底止，本公司之遞延所得稅資產主要係機器設備及研究發展費用投資抵減，得用以抵減以後年度應納稅額如下：

到期年度	投資抵減金額
八十八年度	\$ 305,183
八十九年度	2,170,254
九十年年度	2,642,040

截至八十六年底止，本公司各次增資擴展可享受四年免稅如下：

增資擴展案	免稅期間
二廠第二生產單位	八十二年至八十五年度
電腦輔助設計	八十三年至八十六年度
一廠及二廠之擴建	八十三年至八十六年度
二廠擴建、電腦輔助設計擴充及新增三廠	八十五年至八十八年度
一廠、二廠第一、二生產單位及三廠擴建、新增四廠(申請中)	八十六年至八十九年度

本公司截至八十四年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。

(十四)關係人交易

除已於財務報表及其他附註中揭露者外，重大之關係人交易及餘額彙總如下：

1.關係人之名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
工研院	本公司董事長為工研院之董事
飛利浦公司	股東(持股比例28.19%)
台積國際投資公司	本公司之子公司
台灣積體電路(美國)公司(美國子公司)	本公司之子公司
台灣積體電路(歐洲)公司(歐洲子公司)	本公司之子公司
鑫成科技公司	被投資公司
世界先進積體電路公司(世界先進公司)	被投資公司
WAFERTECH, LLC	本公司子公司(台積國際投資公司) 間接持有之被投資公司

2.關係人交易

	八十六年度		八十五年度	
	金額	百分比	金額	百分比
全年度				
銷貨收入				
工研院	\$ 240,549	1	\$ 214,173	-
飛利浦及其聯屬公司	3,150,057	7	2,641,316	7
世界先進公司	27,681	-	-	-
WAFERTECH, LLC	8,986	-	-	-
	<u>\$3,427,273</u>	<u>8</u>	<u>\$2,855,489</u>	<u>7</u>
租金費用				
工研院	<u>\$ 161,023</u>	<u>80</u>	<u>\$ 124,551</u>	<u>76</u>
製造費用				
飛利浦公司(技術報酬金)	<u>\$ 777,144</u>	<u>100</u>	<u>\$1,031,010</u>	<u>100</u>
鑫成科技公司(加工費)	<u>\$ 282,675</u>	<u>42</u>	<u>\$ 151,197</u>	<u>44</u>

行銷費用				
美國子公司(佣金)	\$ 889,298	59	\$214,883	34
美國子公司(服務費)	41,101	3	26,449	4
歐洲子公司(佣金)	150,964	10	25,302	4
	<u>\$1,081,363</u>	<u>72</u>	<u>\$266,634</u>	<u>42</u>
年底餘額				
應收關係人款項				
工研院	\$ 50,781	10	\$ 53,760	15
飛利浦及其聯屬公司	362,576	72	268,430	76
世界先進公司	3,532	1	529	-
WAFERTECH, LLC	86,141	17	-	-
台積國際投資公司	-	-	29,170	9
歐洲子公司	10	-	-	-
	<u>\$ 503,040</u>	<u>100</u>	<u>\$351,889</u>	<u>100</u>
預付費用及其他流動資產				
預付租金－工研院	\$ 42,277	2	\$ 41,694	18
應付關係人款項				
飛利浦及其聯屬公司	\$ 199,725	25	\$206,044	45
美國子公司	503,505	63	182,315	40
歐洲子公司	88,903	12	24,296	5
鑫成科技公司	2,180	-	35,436	8
工研院	-	-	5,007	2
	<u>\$ 794,313</u>	<u>100</u>	<u>\$453,098</u>	<u>100</u>

上列與關係人交易之價格及收付款條件均與非關係人相當。

(十五)重大長期營業租賃

本公司積體電路第一廠之土地、廠房及部分機器設備係向工業技術研究院(工研院)承租，至九十一年三月底止。目前年租金為168,527仟元(含服務費及管理費)，租約到期時雙方可協議續約。

本公司積體電路第二廠、第三廠、第四廠及第五廠之土地係向新竹科學工業園區管理局承租，租期分別於九十七年三月至一〇二年五月間到期。租金每年共計27,030仟元，到期時可再續約。

前述租約未來五年及以後年度之租金如下：

年度	金額
八十七年度	\$ 201,323
八十八年度	201,323
八十九年度	201,323
九十年度	201,323
九十一年度	74,490
九十二至一〇二年度	248,845
	<u>\$1,128,627</u>

(十六)承諾事項

截至八十六年底止，重大承諾事項如下：

1. 與飛利浦公司簽訂技術合作合約，自七十七年一月一日起，按約定產品銷貨收入淨額之若干比率支付技術報酬金。合約有效期間為十年；除非任何一方在特定條件下預先以書面通知終止合約，合約到期後應自動展期，每

次五年。本公司已於八十六年五月十二日與飛利浦公司修訂上述合約，自八十六年七月九日起生效，合約延展十年，並於到期後自動展期，每次三年。依據上述修訂合約之規定，自修訂合約生效滿五年後，本公司若須支付權利金予任何第三人，該金額可自應支付予飛利浦公司之技術報酬金中扣除，惟每年應支付之技術報酬金仍不得低於特定比例。

2. 於符合特定股權條件，承諾飛利浦及其聯屬公司每年得預訂本公司最高達百分之三十之產能，惟應於合理期間前通知。
3. 與工研院簽訂次微米技術授權契約，於五年內支付授權費129,400仟元(含5%加值型營業稅，業已全數支付)，並按約定產品銷貨收入淨額之一定百分比支付權利金至八十九年底止。另與工研院簽訂技術合作契約，本公司應於契約有效期限內提供經濟部及其指定對象最高達35%之產能。
4. 與TSMC Development, Inc.(台積國際投資公司之子公司)共同簽訂一製造合約。依該約規定，須於WAFERTECH, LLC (TSMC Development, Inc.投資設立之晶圓代工廠)量產後三年內，向其購買至少百分之八十五之產能；若不購足，本公司應就未購足部份產品價款扣除未支出成本後之淨額賠償TSMC Development, Inc.，TSMC Development, Inc.已將此合約之權利讓與WAFERTECH, LLC。
5. 本公司與三家客戶共同簽訂一供應及購買合約。依該約規定，本公司有義務提供且三家客戶有義務購買特定比例之WAFERTECH, LLC產能。若各合約當事人無法供應或購足其承諾之產能時，應就未供應或購足部份產品價款扣除未支出成本後之金額，賠償本約他方當事人。
6. 與若干主要客戶簽訂晶圓代工合約，依合約之規定本公司以預收保證金之方式保留一定產能予該等客戶。截至八十六年底止，該等存入保證金計美金257,342仟元(帳列其他負債)。

(十七) 衍生性金融商品交易

本公司八十六年度從事遠期外匯買賣交易之目的，主要係為規避以外幣計價之淨資產或淨負債因匯率波動所產生之風險，均屬非以交易為目的之交易活動，茲將有關資訊揭露如下：

1. 合約金額及公平價值：

截至八十六年底止，尚未到期之遠期外匯合約金額如下：

	幣別	合約金額 (仟元)	公平價值 (仟元)	到期日	到期值(仟元)
買入遠期外匯	美金	USD690,000	NTD23,195,820	87年1月~87年12月	NTD22,418,570
賣出遠期外匯	美金	USD470,000	NTD15,872,710	87年1月~87年12月	NTD15,256,960

本公司八十六年度就已到期遠期外匯合約所認列之淨益金額為1,859,000仟元。

本公司係以銀行報價所顯示之外匯換匯匯率，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率分別計算個別合約之公平價值。

上述遠期外匯合約係為規避下列淨資產或淨負債之匯率變動風險。

淨資產或淨負債	金額(仟元)
應收帳款	USD 236,831
應付帳款	USD 138,331
應付公司債	USD 363,135
長期借款	USD 156,000
長期股權投資	USD 389,645

八十六年底就上列淨資產或淨負債所認列之淨利益為103,920仟元。

2. 交易風險

(1)信用風險—本公司交易對象皆為國內信用良好之金融機構，預期不致產生重大信用風險。

(2)市場風險—本公司從事遠期外匯交易即在規避外幣淨資產、淨負債或外幣承諾之匯率風險，因是其市場風險已相互抵銷。

3. 現金流量及需求

本公司從事遠期外匯交易即在規避淨資產、淨負債或外幣承諾之匯率變動風險，因到期時有相對之現金流入或流出，故預期無重大之額外現金需求。

本公司八十五年度從事遠期外匯買賣交易之目的，為規避以外幣計價之淨資產或淨負債或規避外幣承諾因匯率波動所產生之風險，均屬非以交易為目的之交易活動，截至八十五年底止，本公司簽訂之遠期外匯合約均已到期，已到期遠期外匯合約所認列之損益金額並不重大。

本公司另於八十三年五月十二日與某銀行訂立為期五年之利率交換合約，金額為美金10,000仟元，用以規避美金銀行借款採浮動利率計息產生之利率變動風險。此項合約已於八十五年六月提前解約，且未發生重大之損失。

(十八)部門別資訊

1. 外銷銷貨資訊

本公司之外銷銷貨明細如下：

地區	八十六年度	八十五年度
美國	\$18,987,227	\$20,037,562
歐洲	3,594,183	4,484,847
新加坡	5,000,890	-
日本	4,730,973	1,078,459
其他	683,147	3,113,979
	<u>\$32,996,420</u>	<u>\$28,714,847</u>

2. 重要客戶資訊

佔本公司銷貨收入百分之十以上之客戶：無

八、合併財務報表

合併資產負債表

民國八十六年及八十五年十二月三十一日

單位：除每股面額外，為新台幣仟元

資產	八十六年底		八十五年底	
	金額	%	金額	%
流動資產				
現金及約當現金	\$12,816,004	10	\$18,746,214	24
短期投資	5,046,150	4	-	-
應收關係人款項	416,889	-	322,719	-
應收票據	234,912	-	121,176	-
應收帳款	9,478,009	8	4,719,958	6
備抵呆帳	(293,087)	-	(155,627)	-
備抵退貨及折讓	(535,214)	-	(454,290)	(1)
存貨	4,876,292	4	2,750,536	4
遞延所得稅資產	816,788	1	137,948	-
預付費用及其他流動資產	1,463,931	1	536,059	1
流動資產合計	34,320,674	28	26,724,693	34
長期股權投資	7,162,460	6	6,545,307	8
固定資產				
成本				
土地	253,652	-	167,035	-
建築物	18,125,783	14	9,768,555	12
機器設備	64,525,249	52	35,079,612	44
辦公設備	962,776	1	703,375	1
	83,867,460	67	45,718,577	57
累積折舊	(26,552,281)	(21)	(18,249,461)	(23)
預付款項及未完工程	21,789,463	17	16,117,787	21
固定資產淨額	79,104,642	63	43,586,903	55
其他資產				
遞延借項—淨額	641,989	1	140,446	-
遞延所得稅資產	3,276,063	2	1,752,843	3
存出保證金	73,585	-	125,067	-
其他	22,734	-	9,250	-
其他資產合計	4,014,371	3	2,027,606	3
資產總計	\$124,602,147	100	\$78,884,509	100

負債及股東權益	八十六年底		八十五年底	
	金額	%	金額	%
流動負債				
應付商業本票	\$ 250,000	-	\$ -	-
應付關係人款項	201,905	-	246,487	1
應付帳款	3,136,944	3	1,045,637	1
應付工程及設備款	10,099,466	8	2,763,885	3
應付所得稅	3,367	-	460,028	1
應計費用及其他流動負債	1,639,640	1	1,027,756	1
流動負債合計	15,331,322	12	5,543,793	7
長期借款	8,025,900	6	5,720,000	7
應付公司債	11,983,457	10	-	-
應計退休金負債	489,117	-	328,729	-
其他負債				
存入保證金	8,516,482	7	8,820,276	11
預收設備款	-	-	795,758	1
少數股權	10,841,476	9	5,562,013	7
負債合計	55,187,754	44	26,770,569	33
股東權益				
股本—每股面額10元，額定八十六年 8,500,000仟股，八十五年3,000,000仟股； 發行—八十六年4,081,300仟股，八十五年 2,654,200仟股	40,813,000	33	26,542,000	34
資本公積	62,082	-	59,086	-
法定公積	4,928,532	4	2,992,429	4
未分配盈餘	23,712,760	19	22,531,027	29
累積換算調整數	(101,981)	-	(10,602)	-
股東權益合計	69,414,393	56	52,113,940	67
負債及股東權益總計	\$124,602,147	100	\$78,884,509	100

合併損益表

民國八十六年及八十五年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘外，為新台幣仟元

	八十六年度		八十五年度	
	金額	%	金額	%
銷貨收入總額	\$44,756,442		\$39,836,725	
銷貨退回及折讓	(829,801)		(436,546)	
銷貨收入淨額	43,926,641	100	39,400,179	100
銷貨成本	22,841,471	52	17,420,930	44
銷貨毛利	21,085,170	48	21,979,249	56
營業費用				
管理費用	2,194,186	6	1,645,849	4
行銷費用	1,457,281	2	604,494	1
研究發展費用	2,505,303	6	1,493,999	4
合計	6,156,770	14	3,744,342	9
營業利益	14,928,400	34	18,234,907	47
營業外收入				
利息收入	954,748	2	802,959	2
處分長期股權投資淨益	310,561	1	39,668	-
按權益法認列之投資收益	-	-	72,507	-
兌換淨益	-	-	107,398	-
處分固定資產利益	3,131	-	40,759	-
其他收入	26,376	-	27,542	-
合計	1,294,816	3	1,090,833	2
營業外費用				
利息費用	546,591	1	277,161	1
兌換淨損	188,884	1	-	-
按權益法認列之投資損失	64,440	-	-	-
公司債發行成本	66,361	-	-	-
處分固定資產損失	7,722	-	10,074	-
其他損失	20,932	-	63	-
合計	894,930	2	287,298	1
稅前利益	15,328,286	35	19,038,442	48
所得稅利益	2,558,516	6	403,305	1
扣除少數股權前利益	17,886,802	41	19,441,747	49
少數股權利益(損失)	73,273	-	(41,058)	-
純益	\$17,960,075	41	\$19,400,689	49
每股盈餘				
按加權平均發行股數八十六年4,081,300				
仟股及八十五年2,654,200仟股計算	\$4.40		\$7.31	
按4,081,300仟股計算			\$4.75	

九、財務狀況及經營結果之檢討分析

(一)流動分析

項目	八十六年 12月31日	八十五年 12月31日	增減比率
流動比率	235.82%	308.50%	-23.56%
速動比率	185.78%	247.77%	-25.02%

(二)經營結果分析

單位：新台幣仟元

項目	八十六年度	八十五年度	增減比率	增減比率
銷貨收入總額	\$44,765,428	\$39,836,725	\$4,928,703	12.37%
銷貨退回折讓	(829,801)	(436,546)	(393,255)	90.08%
銷貨收入淨額	43,935,627	39,400,179	4,535,448	11.51%
銷貨成本	22,841,471	17,420,930	5,420,541	31.12%
銷貨毛利	21,094,156	21,979,249	(885,093)	(4.03%)
營業費用	5,604,376	3,744,003	1,860,373	49.69%
營業利益	15,489,780	18,235,246	(2,745,466)	(15.06%)
營業外收入				
利息收入	501,434	653,462	(152,028)	(23.27%)
按權益法認列之投資收益	17,804	156,152	(138,348)	(88.60%)
兌換淨益	-	107,398	(107,398)	(100.00%)
處分長期股權投資利益	311,453	39,668	271,785	685.15%
處分固定資產利益	3,131	40,759	(37,628)	(92.32%)
其他收入	23,891	27,542	(3,651)	(13.26%)
營業外收入合計	857,713	1,024,981	(167,268)	(16.32%)
營業外費用				
利息費用	546,490	277,161	269,329	97.17%
處分固定資產損失	7,722	10,071	(2,349)	(23.32%)
兌換淨損	188,884	-	188,884	-
公司債發行成本	66,361	-	66,361	-
其他損失	20,933	63	20,870	33,126.98%
營業外費用合計	830,390	287,295	543,095	189.04%
稅前利益	15,517,103	18,972,932	(3,455,829)	(18.21%)
所得稅利益	2,442,972	427,757	2,015,215	471.11%
純益	\$17,960,075	\$19,400,689	(\$1,440,614)	(7.43%)

台灣積體電路製造股份有限公司



董事長兼總經理 張忠謀



刊印日期：民國八十七年三月二十八日



台灣積體電路
製造股份有限公司

新竹科學工業園區
園區三路121號

電話: 886-3-5780221
傳真: 886-3-5781546